



(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2012년09월14일  
(11) 등록번호 10-1181126  
(24) 등록일자 2012년09월03일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)  
G09F 3/03 (2006.01) G09F 3/10 (2006.01)  
(21) 출원번호 10-2010-0047751  
(22) 출원일자 2010년05월21일  
심사청구일자 2010년05월25일  
(65) 공개번호 10-2011-0128218  
(43) 공개일자 2011년11월29일  
(56) 선행기술조사문헌  
KR1020080071219 A\*

(73) 특허권자  
김경중  
서울특별시 마포구 성암로7길 23, 대정빌라 102호  
(성산동)  
(72) 발명자  
김경중  
서울특별시 마포구 성암로7길 23, 대정빌라 102호  
(성산동)

\*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

전체 청구항 수 : 총 9 항

심사관 : 한상일

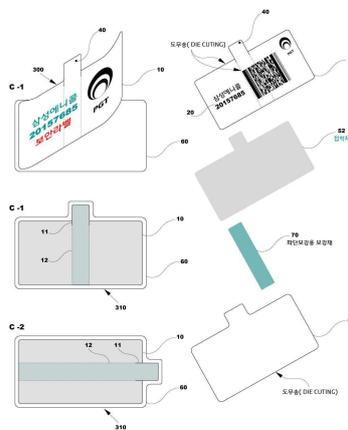
(54) 발명의 명칭 **보안봉인 라벨 및 알에프아이디 보안봉인 라벨**

(57) 요약

- a. 라벨부 전면에 특정 정보표시사항( 로고/ 광코드/ 생산년월일/ 라벨개봉시의 주의사항 등)이 인쇄되며,
- b. RFID 보안봉인라벨의 경우는, 라벨부 배면에 추가적으로 RFID 안테나와 RFID 칩셋을 인쇄와 장착하며,
- c. 목적물에서 라벨 제거시 목적물 상에 개봉 흔적이 명확히 남도록, 라벨부에 라벨 파단선을 도무송 형성하거나, 라벨부 배면으로 분리 흔적부를 제공하며,
- d. 부착자나 개봉자가 라벨부를 과지할 수 있도록 손가락 과지부를 라벨부 일측에 형성하여 제공하며,
- e. 라벨부 배면으로 라벨부가 목적물에 잘 부착되도록 점착제를 도포하며,
- f. 목적물에서 부착 라벨을 제거시, 라벨 파단부나 라벨 흔적부가 라벨부와 분리되어 목적물 상에 붙어있도록 점착제를 포인트 도포하며,
- g. 라벨부가 이형지에서 용이하게 분리 되도록 라벨보다 큰 이형지를 부착하여 제공하거나, 이형지 일부나 전체에 라벨분리 편의부를 형성하여 제공하는,

봉투/ 포장박스/ 포장용기 등에 이용되는 "보안봉인 라벨과 RFID 보안봉인라벨"

대표도 - 도8



**특허청구의 범위**

**청구항 1**

A형 보안봉인 라벨로서,

라벨부(10)/ 포인트 파단부(30,31)/ 손가락 파지부(40)/ 점착제(51)/ 접착제(52)/ 이형지(60)로 구성되며,

- 1). 라벨부 전면에 광코드를 포함하는 정보표시사항(20)이 인쇄되며,
- 2). 라벨부 배면으로 라벨부가 목적물에 잘 부착되도록 점착제(51)를 도포하며,
- 3). 목적물에서 부착 라벨을 제거할 시, 포인트 파단부(30)가 라벨부와 분리되어 목적물 상에 붙어있도록 접착제(52)를 포인트 도포하며,
- 4). 부착자나 개봉자가 라벨부를 파지할 수 있도록 손가락 파지부(40)를 라벨부 일측에 형성하며,
- 5). 목적물에서 라벨 제거시 목적물 상에 개봉 흔적이 명확히 남도록, 라벨부에 포인트 파단부(30,31)를 도무송 형성하며,
- 6). 라벨부가 이형지(60)에서 용이하게 분리 되도록 라벨부 보다 큰 이형지를 부착하거나 라벨부와 동일한 크기로 제공되는,

"A형 보안봉인 라벨"

**청구항 2**

B형 보안봉인 라벨로서,

라벨부(10)/ 손가락 파지부(40)/ 분리촉진제(53)/ 점착제(51)/ 접착제(52)/ 이형지(60)로 구성되며,

- 1). 라벨부 전면에 광코드를 포함하는 정보표시사항(20)이 인쇄되며,
- 2). 라벨부 배면으로 목적물의 개봉상황을 표시하거나 점착제(51)와의 원활한 분리를 위해, 분리촉진제(53)를 도포하거나 부착하고,
- 3). 상기 분리촉진제(53)를 수용한 체, 라벨부 배면으로 라벨부가 목적물에 잘 부착되도록 점착제(51)를 도포하며,
- 4). 목적물에서 부착 라벨을 제거할 시, 분리촉진제(53)가 라벨부와 분리되어 목적물 상에 붙어있도록 점착제(52)를 포인트 도포하며,
- 5). 부착자나 개봉자가 라벨부를 파지할 수 있도록 손가락 파지부(40)를 라벨부 일측에 형성하여 제공하며,
- 6). 라벨부가 이형지(60)에서 용이하게 분리 되도록 라벨부 보다 큰 이형지를 부착하거나 라벨부와 동일한 크기로 제공되는,

"B형 보안봉인 라벨"

**청구항 3**

C형 보안봉인 라벨로서,

라벨부(10)/ 손가락 파지부(40)/ 라벨 파단부(11,12)/ 점착제(52)/ 파단보강제(70)/ 이형지(60)로 구성되며,

- 1). 라벨부 전면에 광코드를 포함하는 정보표시사항(20)이 인쇄되며,
- 2). 라벨부 배면으로 라벨부가 목적물에 잘 점착되도록 점착제(52)를 도포하며,
- 3). 목적물에서 부착 라벨을 제거할 시, 라벨 파단부가 목적물에서 잘 파단분리 되도록 파단보강제(70)를 점착제 배면으로 부설하며,
- 4). 부착자나 개봉자가 라벨부를 파지할 수 있도록 손가락 파지부(40)를 라벨부 일측에 형성하며,

5). 목적물에서 라벨 과단부를 제거시, 라벨부와 접착부가 명확히 과단분리 되도록, 라벨부에 라벨 과단부를 도무송(11,12) 형성하며,

6). 라벨부가 이형지(60)에서 용이하게 분리 되도록 라벨부 보다 큰 이형지를 부착하거나 라벨부와 동일한 크기로 제공되는,

"C형 보안봉인 라벨"

#### 청구항 4

A형 RFID 보안봉인 라벨로서,

라벨부(10)/ 손가락 과지부(40)/ 포인트 과단부(30)/ RFID TAG 모듈(81,82)/ 점착제(51)/ 점착제(52)/ 이형지(60)로 구성되며,

- 1). 라벨부 전면에 광코드를 포함하는 정보표시사항(20)이 인쇄되며,
- 2). 라벨부 배면에 RFID TAG 기능을 수행하기 위한, RFID 안테나(81)를 인쇄하며 인쇄된 RFID 안테나 위로 RFID 칩셋(82)을 장착하고,
- 3). RFID TAG 모듈이 부착된 라벨부 배면으로, 라벨부가 목적물에 잘 부착되도록 점착제(51)를 도포하며,
- 4). 목적물에서 부착 라벨을 제거할 시, 포인트 과단부(30)가 라벨부와 분리되어 목적물 상에 붙어 있도록 점착제(52)를 포인트 도포하며,
- 5). 부착자나 개봉자가 라벨부를 과지할 수 있도록 손가락 과지부(40)를 라벨부 일측에 형성하며,
- 6). 목적물에서 라벨 제거시 목적물 상에 개봉 흔적이 명확히 남도록, 라벨부에 포인트 과단부(30)를 도무송 형성하며,
- 7). 라벨부가 이형지(60)에서 용이하게 분리 되도록 라벨부 보다 큰 이형지를 부착하거나 라벨부와 동일한 크기로 제공되는,

"A형 RFID 보안봉인 라벨"

#### 청구항 5

B형 RFID 보안봉인 라벨로서,

라벨부(10)/ 손가락 과지부(40)/ RFID TAG 모듈(81,82)/ 분리촉진제(53)/ 점착제(51)/ 점착제(52)/ 이형지(60)로 구성되며,

- 1). 라벨부 전면에 광코드를 포함하는 정보표시사항(20)이 인쇄되며,
- 2). 라벨부 배면에 RFID 기능을 수행하기 위한, RFID 안테나(81)를 인쇄하며 인쇄된 RFID 안테나 위로 RFID 칩셋(82)을 장착하고,
- 3). 라벨부 배면으로 목적물의 개봉상황을 표시하거나 점착제(51)와의 원활한 분리를 위해, 분리촉진제(53)를 도포하거나 부착하고,
- 4). 상기 분리촉진제(53)를 수용한 체, 라벨부 배면으로 라벨부가 목적물에 잘 부착되도록 점착제(51)를 도포하며,
- 5). 목적물에서 부착 라벨을 제거할 시, 분리촉진제(53)가 라벨부와 분리되어 목적물 상에 붙어있도록 점착제(52)를 포인트 도포하며,
- 6). 부착자나 개봉자가 라벨부를 과지할 수 있도록 손가락 과지부(40)를 라벨부 일측에 형성하여 제공하며,
- 7). 라벨부가 이형지(60)에서 용이하게 분리 되도록 라벨부 보다 큰 이형지를 부착하거나 라벨부와 동일한 크기로 제공되는,

"B형 RFID 보안봉인 라벨"

#### 청구항 6

C형 RFID 보안봉인 라벨로서,

라벨부(10)/ 손가락 파지부(40)/ RFID TAG 모듈(81,82)/ 라벨 파단부(11,12)/ 접착제(52)/ 파단보강제(70)/ 이형지(60)로 구성되며,

- 1). 라벨부 전면에 광코드를 포함하는 정보표시사항(20)이 인쇄되며,
- 2). 라벨부 배면에 RFID TAG 기능을 수행하기 위한, RFID 안테나(81)를 인쇄하며 인쇄된 RFID 안테나 위로 RFID 칩셋(82)을 장착하고,
- 3). 라벨부 배면으로 라벨부가 목적물에 잘 접촉되도록 접착제(52)를 도포하며,
- 4). 목적물에서 부착 라벨을 제거할 시, 라벨 파단부가 목적물에서 잘 파단분리 되도록 파단보강제(70)를 접착제 배면으로 부설하며,
- 5). 부착자나 개봉자가 라벨부를 파지할 수 있도록 손가락 파지부(40)를 라벨부 일측에 형성하여 제공하며,
- 6). 목적물에서 라벨 파단부를 제거시, 라벨부와 접착부가 명확히 파단분리 되도록, 라벨부에 라벨 파단부를 도무송(11,12) 형성하며,
- 7). 라벨부가 이형지(60)에서 용이하게 분리 되도록 라벨부 보다 큰 이형지를 부착하거나 라벨부와 동일한 크기로 제공되는,

"C형 RFID 보안봉인 라벨"

#### 청구항 7

청구항 4항에 있어서,

RFID TAG 모듈(81,82)의 RFID 안테나의 인쇄와 RFID 칩셋 장착을 대신하여,

RFID 안테나와 RFID 칩셋이 성형체 안에 일체로 내장된 RFID TAG 모듈(83) 또는 RFID 안테나와 RFID 칩셋이 길고 얇게 형성된 무칩 In Lay RFID TAG 모듈(84)을,

라벨부 배면의 일측에 장착하여 제공하는,

"A형 RFID 보안봉인 라벨"

#### 청구항 8

청구항 5항에 있어서,

RFID TAG 모듈(81,82)의 RFID 안테나의 인쇄와 RFID 칩셋 장착을 대신하여,

RFID 안테나와 RFID 칩셋이 성형체 안에 일체로 내장된 RFID TAG 모듈(83) 또는 RFID 안테나와 RFID 칩셋이 길고 얇게 형성된 무칩 In Lay RFID TAG 모듈(84)을,

라벨부 배면의 일측에 장착하여 제공하는,

"B형 RFID 보안봉인 라벨"

#### 청구항 9

청구항 6항에 있어서,

RFID TAG 모듈(81,82)의 RFID 안테나의 인쇄와 RFID 칩셋 장착을 대신하여,

RFID 안테나와 RFID 칩셋이 성형체 안에 일체로 내장된 RFID TAG 모듈(83) 또는 RFID 안테나와 RFID 칩셋이 길고 얇게 형성된 무칩 In Lay RFID TAG 모듈(84)을,

라벨부 배면의 일측에 장착하여 제공하는,

"C형 RFID 보안봉인 라벨"

### 명세서

**기술분야**

[0001] 라벨 제작기술, RFID 및 광코드 라벨 제작기술

**배경기술**

[0002] 사회가 발전하면서 사람이 접하는 기밀서류/ 기밀샘플/ 고가상품/ 보증제품 등의 진위/보안/도난 등의 관리에 생산자나 발신자는 많은 신경을 써야하는 시대가 되었다. 이러한 서류/제품/상품의 진위/보안/도난 등의 관리에는, 보통의 경우 발신되는 서류봉투의 개봉부위를 폴로 접착하거나, 샘플/상품의 개봉부위를 테이프로 밀봉한다.

[0003] 또한 근래에는 이러한 부위에 RFID 라벨을 사용하여 고가품의 도난관리/정품관리/재고관리/고객관리를 하고자 하는 노력이 수반되고 있다. 이러한 RFID 기술과 광판독 기술은 생산관리, 창고관리, 출하관리, 판매관리뿐만 아니라, 태그인식 및 정보제공 기술의 발달로 상품정보는 물론, 정품과 비정품을 구별하여 주기까지 한다. 또한 RFID 칩셋소형화의 기술 진보로, 이러한 극소형 칩셋들이 인체내 정보용으로 쓰이거나, 심지어 우리가 흔히 사용하는 종이화폐/ 상품권 등의 유가증권에 삽입되어 사용되고 있으며, 이러한 RF 기술과 광판독 기술은 {산업의 자동화/ 쇼핑자의 편리제공/ 진위확인/ 도난방지/ 고객이벤트/ 출입관리/ 시설관리 등}에 광범위로 활용되고 있다.

[0004] 따라서 진위식별/도난예방/재고관리/고객관리 등을 위한 "정보기록용 라벨과 정보기록용 RFID 라벨"의 중요성은 더욱 커지고 있다.

[0005] 종래에 기 제안된 보안라벨/ 봉인라벨/ 개봉확인라벨/ 물품보호라벨/ 도난방지라벨 { "등록특허 10-0392912 라벨", "등록실용 20-0396941 개봉 여부를 확인할 수 있는 점착 라벨", "등록특허 10-0581131 위변조 방지용 기능성 스티커 라벨 및 이의 제조방법", "등록특허 10-0668148 보안용 스티커 및 그 제조방법", "등록특허 10-0751836 보안태그 및 물건 보호 방법 - RFID 라벨", "등록특허 10-0867983 개봉 여부 확인이 가능한 정보 보안 스티커", "공개특허 10-2009-0117311 봉인이 가능한 RFID 스티커" }를 고찰하면,

[0006] 상기 기 제안기술은 포장부에 접착된 라벨의 개봉 여부에 따라 라벨이 파단되거나 포장부위에 특정 표식이 나타나게 제안되었다.

**발명의 내용**

**해결하려는 과제**

[0007] 그러나 종래의 보안봉인 라벨과 RFID 보안봉인 라벨은,

[0008] a.비교적 제작방법이 복잡하여 그 사용효과를 확인하기 어렵고,

[0009] b.라벨 부착자의 편리성을 위한 수단(라벨을 이형지에서 떼어 목적물에 부착시키는 수단)이 결여되었으며,

[0010] c.최종 개봉자를 위한 개봉편리수단이 제공되지 않고 있다.

**과제의 해결 수단**

[0011] 보안봉인 라벨과 RFID 보안봉인라벨의 제작에 있어서

[0012] a.목적물에서 라벨 제거시 목적물 상에 개봉흔적이 명확히 남도록, 라벨 파단부나 분리 흔적부가 제공되며,

[0013] b.부착자나 개봉자의 손가락으로 라벨을 파지할 수 있도록, 손가락 파지부를 형성하여 제공하며,

[0014] c.분리되는 라벨보다 큰 이형지를 부착하여 제공하거나,

[0015] 이형지 일부나 전체에 라벨분리 편의부를 형성하여 제공한다.

**발명의 효과**

[0016] 본 발명인 보안봉인 라벨 및 RFID 보안봉인 라벨은,

- [0017] a. 생산공정이 단순하여 생산비가 저렴하며,
- [0018] b. 라벨 부착자가 이형지에서 라벨을 분리하기 용이하며,
- [0019] c. 최종 개봉자가 목적물(봉투/ 포장박스/ 포장용기 등)에서 라벨을 분리/파단 시키기가 용이하다.

**도면의 간단한 설명**

- [0020] 도 1: A형 보안봉인 라벨을 포장박스에 적용하여 사용한 예.
- 도 2: A형 보안봉인 라벨의 설계 및 구성요소도.
- 도 3: A형 보안봉인 라벨의 제작공정 및 제공방법.
- 도 4: B형 보안봉인 라벨을 포장박스에 적용하여 사용한 예.
- 도 5: B형 보안봉인 라벨의 설계 및 구성요소도.
- 도 6: B형 보안봉인 라벨의 제작공정 및 제공방법.
- 도 7: C형 보안봉인 라벨을 포장박스에 적용하여 사용한 예.
- 도 8: C형 보안봉인 라벨의 설계 및 구성요소도.
- 도 9: C형 보안봉인 라벨의 제작공정 및 제공방법.
- 도 10: RFID 보안봉인 A형 라벨을 포장박스에 적용하여 사용한 예.
- 도 11: RFID 보안봉인 A형 라벨의 설계 및 구성요소도.
- 도 12: RFID 보안봉인 A형 라벨의 제작공정 및 제공방법.
- 도 13: RFID 보안봉인 B형 라벨을 포장박스에 적용하여 사용한 예.
- 도 14: RFID 보안봉인 B형 라벨의 설계 및 구성요소도.
- 도 15: RFID 보안봉인 B형 라벨의 제작공정 및 제공방법.
- 도 16: RFID 보안봉인 C형 라벨을 포장박스에 적용하여 사용한 예.
- 도 17: RFID 보안봉인 C형 라벨의 설계 및 구성요소도.
- 도 18: RFID 보안봉인 C형 라벨의 제작공정 및 제공방법.
- 도 19: 미니 RFID 모듈 부착형 보안봉인 A형 라벨의 설계 및 구성요소도.
- 도 20: 미니 RFID 모듈 부착형 보안봉인 B형 라벨의 설계 및 구성요소도.
- 도 21: 미니 RFID 모듈 부착형 보안봉인 C형 라벨의 설계 및 구성요소도.
- 도 22: 뮤칩 In Lay RFID 모듈 부착형 보안봉인 A형 라벨의 설계 및 구성요소도.
- 도 23: 뮤칩 In Lay RFID 모듈 부착형 보안봉인 B형 라벨의 설계 및 구성요소도.
- 도 24: 뮤칩 In Lay RFID 모듈 부착형 보안봉인 C형 라벨의 설계 및 구성요소도.
- 도 25: 보안봉인라벨/ RFID보안봉인라벨의 이형지와 손가락 파지부의 다양한 유형.
- 도 26: 라벨부와 이형지 분리 편의를 위한, 이형지 가공의 다른 예.

**발명을 실시하기 위한 구체적인 내용**

- [0021] 봉투/ 포장박스/ 포장용기 등에 이용되는 "보안봉인 라벨과 RFID 보안봉인라벨"로서 제시한 도면에 의하여 기술한 라벨별 구성과 제작방법은 다음과 같다.
- [0022] 참고로 라벨 구성요소로 기술된 용어 중;
- [0023] "라벨지"는 종이(아트지/모조지 등)나 필름( PET/ PP/ PE 등)을 지칭하며, 또는 종이에 얇은 필름을 합지 하거

나, 얇은 필름 막을 코팅 형성한 것을 의미하며,

[0024] 점착제를 "점착제"와 "접착제"로 구분하여 기술하나, 이는 모두 점착제 범주에 속한 것으로, 특별히 "접착제"는 일반 점착제에 비해 강한 점착력이 있어 부착된 목적물에서 제거(떼어냄)하기가 힘든 성분의 점착제를 의미하며,

광코드란 용어는 {바코드/ 2차원코드/ PDF417/ QR코드/ 이미지코드/ 칼라코드 등}을 총칭하며, 정보기록의 우수성, 광판독 기기에서 판독과 업무처리의 우수성, 광판독 디지털 기기에서 웹접속 기능의 우수성이 유리한 광코드를 상황에 따라 선택 적용할 수 있으며,

[0025] "도무송"은 인쇄물(필름/종이가공품)을 절단시키거나 과단 시키는 제작 공정용어로, 목형틀에 심는 칼의 깊이(높낮이)에 따라, 라벨부 보다 이형지를 크게하여 합지된 라벨부와 이형지를 동시에 절단 및 과단 시킬 수 있으며, 일부에서 "툽스/ 다이커팅"으로도 불리운다.

[0026] **1. A형 보안봉인 라벨**

[0027] [도 1,2,3]은 A형 보안봉인 라벨의 사용예/ 구성요소/ 제작방법 및 제공방법을 기술하였으며,

[0028] A: A형 보안봉인 라벨의 구성은;

[0029] [도 2]와 같이, 라벨부(100)와 이형지(60)로 구성되며,

[0030] 1). 라벨부(100) 전면에 정보표시사항(로고/ 광코드/ 생산년월일/ 라벨개봉시의 주의사항 등)(20)이 인쇄되며,

[0031] 2). 라벨부 배면으로 라벨부가 목적물에 잘 부착되도록 점착제(51)를 도포하며,

[0032] 3). 목적물에서 부착 라벨을 제거할 시, 포인트 과단부(30)가 라벨부와 분리되어 목적물 상에 붙어있도록 점착제(52)를 포인트 도포하며,

[0033] 4). 부착자나 개봉자가 라벨부를 파지할 수 있도록 손가락 파지부(40)를 라벨부 일측에 형성하여 제공하며,

[0034] 5). 목적물에서 라벨 제거시 목적물 상에 개봉 흔적이 명확히 남도록, 라벨부에 포인트 과단부(30,31)를 도무송 형성하며,

[0035] 6). 라벨부가 이형지(60)에서 용이하게 분리 되도록 라벨부 보다 큰 이형지를 부착하여 제공하거나, 라벨부와 동일한 크기로 이형지가 가공될 시 필요에 따라 이형지 일부나 전체에 라벨분리 편의부(90,91,92) {참고-[도 26]}를 형성하여 제공한다.

[0036] B: A형 보안봉인 라벨의 제작방법과 제공방법은;

[0037] [도 2,3]과 같이,

[0038] 1). 라벨지 원판과 이형지 원판(또는 롤형 라벨 원지와 롤형 이형지)을 준비하고,

[0039] 2). 라벨지(10) 전면에 특정 정보표시사항(20)을 인쇄하며,

[0040] 3). 라벨지(10) 배면의 떼어내는 손가락 파지부(40)와 점착제(52) 도포 자리를 제외한 점착제 자리에 점착제(51)를 도포하고, (또는 [도 25]의 "라벨배면 점착제 도포후 손가락 파지보조제 부착형"과 같이, 점착제 도포 크기를 라벨부 크기와 동일하게 도포한 후 파지보조제를 점착면에 덧 부착하여 제공할 수도 있음)

[0041] 4). 라벨지(10) 배면의 점착제 포인트 위치에 점착제(52)를 도포하고,

[0042] 5). 점착제(51)과 점착제(52)가 도포된 라벨지(10) 배면에 이형지(60)를 합지하고,

[0043] 6). 라벨부(100) 외곽/ 포인트 과단부(30)/ 이형지(60) 외곽을 도무송 한 후,

[0044] 7). 보안봉인라벨의 불필요 부분을 제거하여 포장공급한다.

[0045] \*.상기 제작공정 2번 항목의, 특정 정보사항의 인쇄는;

[0046] a. 5번 항목의 합지 후 인쇄하거나,

[0047] b. 6번 항목의 도무송 가공 후 인쇄하거나,

[0048] c. 인쇄 없이 판형세트나 롤형으로 제공하여, 사용자가 직접 프린트할 수도 있다.

[0049] **2. B형 보안봉인 라벨**

[0050] [도 4,5,6]은 B형 보안봉인 라벨의 사용예/ 구성요소/ 제작방법 및 제공방법을 기술하였으며,

[0051] A: B형 보안봉인 라벨의 구성은;

[0052] [도 5]와 같이, 라벨부(200)와 이형지(60)로 구성되며,

[0053] 1). 라벨부(100) 전면에 정보표시사항(로고/ 광고코드/ 생산년월일/ 라벨개봉시의 주의사항 등)(20)이 인쇄되며,

[0054] 2). 라벨부 배면으로 목적물의 개봉상황을 표시하거나 점착제(51)와의 원활한 분리를 위해, 분리촉진제( 금속분말/ 왁스/ 필름 등)(53)를 단독 또는 병합사용하여 도포하거나 부착하고,

[0055] 3). 상기 분리촉진제(53)를 수용한 체, 라벨부 배면으로 라벨부가 목적물에 잘 부착되도록 점착제(51)를 도포하며,

[0056] 4). 목적물에서 부착 라벨을 제거할 시, 분리촉진제(53)가 라벨부와 분리되어 목적물 상에 붙어있도록 점착제(52)를 포인트 도포하며,

[0057] 5). 부착자나 개봉자가 라벨부를 파지할 수 있도록 손가락 파지부(40)를 라벨부 일측에 형성하여 제공하며,

[0058] 6). 라벨부가 이형지(60)에서 용이하게 분리 되도록 라벨부 보다 큰 이형지를 부착하여 제공하거나, 라벨부와 동일한 크기로 이형지가 가공될 시 필요에 따라 이형지 일부나 전체에 라벨분리 편의부(90,91,92) {참고-[도 26]}를 형성하여 제공한다.

[0059] B: B형 보안봉인 라벨의 제작방법과 제공방법은;

[0060] [도 5,6]과 같이,

[0061] 1). 라벨지 원판과 이형지 원판(또는 롤형 라벨 원지와 롤형 이형지)을 준비하고,

[0062] 2). 라벨지(10) 전면에 특정 정보표시사항(20)을 인쇄하며,

[0063] 3). 라벨지 배면으로 목적물의 개봉상황을 표시하거나 점착제(51)와의 원활한 분리를 위해, 분리촉진제( 금속분말/ 왁스/ 필름 등)(53)를 단독 또는 병합사용하여 도포하거나 부착하고,

[0064] 4). 라벨지(10) 배면의 떼어내는 손가락 파지부(40)과 분리촉진제(53) 자리를 제외한 점착제 자리에 점착제(51)를 도포하고, (또는 [도 25]의 "라벨배면 점착제 도포후 손가락 파지보조제 부착형"과 같이, 점착제 도포크기를 라벨부 크기와 동일하게 도포한 후 파지보조제를 점착면에 덧 부착하여 제공할 수도 있음)

[0065] 5). 라벨지(10) 배면의 분리촉진제(53) 위치에 점착제(52)를 도포하고,

[0066] 6). 분리촉진제(53)/ 점착제(51)/ 점착제(52)가 도포된 라벨지(10) 배면에 이형지(60)를 합지하고,

[0067] 7). 라벨부(200) 외곽/ 이형지(60) 외곽을 도무송 한 후,

[0068] 8). 보안봉인라벨의 불필요 부분을 제거하여 포장공급한다.

[0069] \*.상기 제작공정 2번 항목의, 특정 정보사항의 인쇄는;

[0070] a. 6번 항목의 합지 후 인쇄하거나,

[0071] b. 7번 항목의 도무송 가공 후 인쇄하거나,

[0072] c. 인쇄 없이 판형세트나 롤형으로 제공하여, 사용자가 직접 프린트할 수도 있다.

[0073] **3. C형 보안봉인 라벨**

[0074] [도 7,8,9]는 C형 보안봉인 라벨의 사용예/ 구성요소/ 제작방법 및 제공방법을 기술하였으며,

- [0075] A: C형 보안봉인 라벨의 구성은;
- [0076] [도 8]와 같이, 라벨부(300)와 이형지(60)로 구성되며,
- [0077] 1). 라벨부(300) 전면에 정보표시사항(로고/ 광코드/ 생산년월일/ 라벨개봉시의 주의사항 등)(20)이 인쇄되며,
- [0078] 2). 라벨부 배면으로 라벨부가 목적물에 잘 접촉되도록 접착제(52)를 도포하며,
- [0079] 3). 목적물에서 부착 라벨을 제거할 시, 라벨 파단부가 목적물에서 잘 파단분리 되도록 파단보강제(종이/필름/노끈/리본 등)(70)를 접착제 배면으로 부설하며,
- [0080] 4). 부착자나 개봉자가 라벨부를 파지할 수 있도록 손가락 파지부(40)를 라벨부 일측에 형성하여 제공하며,
- [0081] 5). 목적물에서 라벨 파단부를 제거시, 라벨부와 접착부가 명확히 파단분리 되도록, 라벨부에 라벨 파단부를 도무송(11,12) 형성하며,
- [0082] 6). 라벨부가 이형지(60)에서 용이하게 분리 되도록 라벨부 보다 큰 이형지를 부착하여 제공하거나, 라벨부와 동일한 크기로 이형지가 가공될 시 필요에 따라 이형지 일부나 전체에 라벨분리 편의부(90,91,92) {참고-[도 26]}를 형성하여 제공한다.

[0083] B: C형 보안봉인 라벨의 제작방법과 제공방법은;

- [0084] [도 8,9]과 같이,
- [0085] 1). 라벨지 원판과 이형지 원판(또는 롤형 라벨 원지와 롤형 이형지)을 준비하고,
- [0086] 2). 라벨지(10) 전면에 특정 정보표시사항(20)을 인쇄하며,
- [0087] 3). 라벨지(10) 배면의 접착제 자리에 접착제(52)를 도포하고,
- [0088] 4). 파단보강제(종이/필름/노끈/리본 등)(70)를 접착제 배면으로 부설하며,
- [0089] 5). 접착제(52)/ 파단보강제(70)가 형성된 라벨지(10) 배면에 이형지(60)를 합지하고,
- [0090] 6). 라벨부(300) 외곽/ 이형지(60) 외곽을 도무송 한 후,
- [0091] 7). 보안봉인라벨의 불필요 부분을 제거하여 포장공급한다.

[0092] \*.상기 제작공정 2번 항목의, 특정 정보사항의 인쇄는;

- [0093] a. 5번 항목의 합지 후 인쇄하거나,
- [0094] b. 6번 항목의 도무송 가공 후 인쇄하거나,
- [0095] c. 인쇄 없이 판형세트나 롤형으로 제공하여, 사용자가 직접 프린트할 수도 있다.

[0096] **4. A형 RFID 보안봉인 라벨**

[0097] [도 10,11,13]은 A형 RFID 보안봉인 라벨의 사용예/ 구성요소/ 제작방법 및 제공방법을 기술하였으며,

[0098] A: A형 RFID 보안봉인 라벨의 구성은;

- [0099] [도 11]과 같이, 라벨부(100)와 이형지(60)로 구성되며,
- [0100] 1). 라벨부(100) 전면에 정보표시사항(로고/ 광코드/ 생산년월일/ 라벨개봉시의 주의사항 등)(20)이 인쇄되며,
- [0101] 2). 라벨부 배면에 RFID 기능을 수행하기 위한, RFID 안테나(81)를 인쇄하며 인쇄된 RFID 안테나 위로 RFID 칩셋(82)을 장착하고,
- [0102] 3). RFID TAG 모듈이 부착된 라벨부 배면으로, 라벨부가 목적물에 잘 부착되도록 접착제(51)를 도포하며,
- [0103] 4). 목적물에서 부착 라벨을 제거할 시, 포인트 파단부(30)가 라벨부와 분리되어 목적물 상에 붙어 있도록 접착제(52)를 포인트 도포하며,

- [0104] 5). 부착자나 개봉자가 라벨부를 파지할 수 있도록 손가락 파지부(40)를 라벨부 일측에 형성하여 제공하며,
- [0105] 6). 목적물에서 라벨 제거시 목적물 상에 개봉 흔적이 명확히 남도록, 라벨부에 포인트 파단부(30)를 도무송 형성하며,
- [0106] 7). 라벨부가 이형지(60)에서 용이하게 분리 되도록 라벨부 보다 큰 이형지를 부착하여 제공하거나, 라벨부와 동일한 크기로 이형지가 가공될 시 필요에 따라 이형지 일부나 전체에 라벨분리 편외부(90,91,92) {참고-[도 26]}를 형성하여 제공한다.
- [0107] B: A형 RFID 보안봉인 라벨의 제작방법과 제공방법은;
- [0108] [도 11,12]과 같이,
- [0109] 1). 라벨지 원판과 이형지 원판(또는 롤형 라벨 원지와 롤형 이형지)을 준비하고,
- [0110] 2). 라벨지(10) 전면에 특정 정보표시사항(20)을 인쇄하며,
- [0111] 3). 라벨지 배면에 RFID TAG 기능을 수행하기 위한, RFID 안테나(81)를 인쇄하며 인쇄된 RFID 안테나 위로 RFID 칩셋(82)을 장착하고,
- [0112] 4). 라벨지(10) 배면의 떼어내는 손가락 파지부(40)와 점착제(52) 도포 자리를 제외한 점착제 자리에 점착제(51)를 도포하고, (또는 [도 25]의 "라벨배면 점착제 도포후 손가락 파지보조제 부착형"과 같이, 점착제 도포 크기를 라벨부 크기와 동일하게 도포한 후 파지보조제를 점착면에 덧 부착하여 제공할 수도 있음)
- [0113] 5). 라벨지(10) 배면의 점착제 포인트 위치에 점착제(52)를 도포하고,
- [0114] 6). RFID TAG 모듈/ 점착제(51)/ 점착제(52)가 부착/도포된 라벨지(10) 배면에 이형지(60)를 합지하고,
- [0115] 7).라벨부(100) 외곽/ 포인트 파단부(30)/ 이형지(60) 외곽을 도무송 한 후,
- [0116] 8). RFID 보안봉인라벨의 불필요 부분을 제거하여 포장공급한다.
- [0117] \*.상기 제작공정 2번 항목의, 특정 정보사항의 인쇄는;
- [0118] a. 6번 항목의 합지 후 인쇄하거나,
- [0119] b. 7번 항목의 도무송 가공 후 인쇄하거나,
- [0120] c. 인쇄 없이 판형세트나 롤형으로 제공하여, 사용자가 직접 프린트할 수도 있다.

[0121] **5. B형 RFID 보안봉인 라벨**

- [0122] [도 13,14,15]는 B형 RFID 보안봉인 라벨의 사용예/ 구성요소/ 제작방법 및 제공방법을 기술하였으며,
- [0123] A: B형 RFID 보안봉인 라벨의 구성은;
- [0124] [도 14]와 같이, 라벨부(200)와 이형지(60)로 구성되며,
- [0125] 1). 라벨부(200) 전면에 정보표시사항(로고/ 광코드/ 생산년월일/ 라벨개봉시의 주의사항 등)(20)이 인쇄되며,
- [0126] 2). 라벨부 배면에 RFID TAG 기능을 수행하기 위한, RFID 안테나(81)를 인쇄하며 인쇄된 RFID 안테나 위로 RFID 칩셋(82)을 장착하고,
- [0127] 3). 라벨부 배면으로 목적물의 개봉상황을 표시하거나 점착제(51)와의 원활한 분리를 위해, 분리촉진제(왁스/ 필름 등)(53)를 단독 또는 병합사용하여 도포하거나 부착하고,
- [0128] 4). 상기 분리촉진제(53)를 수용한 체, 라벨부 배면으로 라벨부가 목적물에 잘 부착되도록 점착제(51)를 도포하며,
- [0129] 5). 목적물에서 부착 라벨을 제거할 시, 분리촉진제(53)가 라벨부와 분리되어 목적물 상에 붙어있도록 점착제(52)를 포인트 도포하며,
- [0130] 6). 부착자나 개봉자가 라벨부를 파지할 수 있도록 손가락 파지부(40)를 라벨부 일측에 형성하여 제공하며,

- [0131] 7. 라벨부가 이형지(60)에서 용이하게 분리 되도록 라벨부 보다 큰 이형지를 부착하여 제공하거나, 라벨부와 동일한 크기로 이형지가 가공될 시 필요에 따라 이형지 일부나 전체에 라벨분리 편의부(90,91,92) {참고-[도 26]}를 형성하여 제공한다.
- [0132] B: B형 RFID 보안봉인 라벨의 제작방법과 제공방법은;
- [0133] [도 14,15]와 같이,
- [0134] 1). 라벨지 원판과 이형지 원판(또는 롤형 라벨 원지와 롤형 이형지)을 준비하고,
- [0135] 2). 라벨지(10) 전면에 특정 정보표시사항(20)을 인쇄하며,
- [0136] 3). 라벨부 배면에 RFID TAG 기능을 수행하기 위한, RFID 안테나(81)를 인쇄하며 인쇄된 RFID 안테나 위로 RFID 칩셋(82)을 장착하고,
- [0137] 4). 라벨지 배면으로 목적물의 개봉상황을 표시하거나 점착제(51)와의 원활한 분리를 위해, 분리촉진제(왁스/ 필름 등)(53)를 단독 또는 병합사용하여 도포하거나 부착하고,
- [0138] 5). 라벨지(10) 배면의 떼어내는 손가락 파지부(40)과 분리촉진제(53) 자리를 제외한 점착제 자리에 점착제(51)를 도포하고, (또는 [도 25]의 "라벨배면 점착제 도포후 손가락 파지보조제 부착형"과 같이, 점착제 도포기를 라벨부 크기와 동일하게 도포한 후 파지보조제를 점착면에 덧 부착하여 제공할 수도 있음)
- [0139] 6). 라벨지(10) 배면의 분리촉진제(53) 위치에 점착제(52)를 도포하고,
- [0140] 7). 분리촉진제(53)/ 점착제(51)/ 점착제(52)가 도포된 라벨지(10) 배면에 이형지(60)를 합지하고,
- [0141] 8). 라벨부(200) 외곽/ 이형지(60) 외곽을 도무송 한 후,
- [0142] 9). RFID 보안봉인라벨의 불필요 부분을 제거하여 포장공급한다.
- [0143] \*.상기 제작공정 2번 항목의, 특정 정보사항의 인쇄는;
- [0144] a. 7번 항목의 합지 후 인쇄하거나,
- [0145] b. 8번 항목의 도무송 가공 후 인쇄하거나,
- [0146] c. 인쇄 없이 판형세트나 롤형으로 제공하여, 사용자가 직접 프린트할 수도 있다.
- [0147] **6. C형 RFID 보안봉인 라벨**
- [0148] [도 16,17,18]은 C형 RFID 보안봉인 라벨의 사용예/ 구성요소/ 제작방법 및 제공방법을 기술하였으며,
- [0149] A: C형 RFID 보안봉인 라벨의 구성은;
- [0150] [도 17]와 같이, 라벨부(300)와 이형지(60)로 구성되며,
- [0151] 1). 라벨부(300) 전면에 정보표시사항(로고/ 광코드/ 생산년월일/ 라벨개봉시의 주의사항 등)(20)이 인쇄되며,
- [0152] 2). 라벨부 배면에 RFID TAG 기능을 수행하기 위한, RFID 안테나(81)를 인쇄하며 인쇄된 RFID 안테나 위로 RFID 칩셋(82)을 장착하고,
- [0153] 3). 라벨부 배면으로 라벨부가 목적물에 잘 점착되도록 점착제(52)를 도포하며,
- [0154] 4). 목적물에서 부착 라벨을 제거할 시, 라벨 파단부가 목적물에서 잘 파단분리 되도록 파단보강제(종이/ 필름/노끈/리본 등)(70)를 점착제 배면으로 부설하며,
- [0155] 5). 부착자나 개봉자가 라벨부를 파지할 수 있도록 손가락 파지부(40)를 라벨부 일측에 형성하여 제공하며,
- [0156] 6). 목적물에서 라벨 파단부를 제거시, 라벨부와 점착부가 명확히 파단분리 되도록, 라벨부에 라벨 파단부를 도무송(11,12) 형성하며,
- [0157] 7). 라벨부가 이형지(60)에서 용이하게 분리 되도록 라벨부 보다 큰 이형지를 부착하여 제공하거나, 라벨부와 동일한 크기로 이형지가 가공될 시 필요에 따라 이형지 일부나 전체에 라벨분리 편의부(90,91,92) {참고-[도

26}}를 형성하여 제공한다.

B: C형 RFID 보안봉인 라벨의 제작방법과 제공방법은;

[도 17,18]과 같이,

- 1). 라벨지 원판과 이형지 원판(또는 롤형 라벨 원지와 롤형 이형지)을 준비하고,
- 2). 라벨지(10) 전면에 특정 정보표시사항(20)을 인쇄하며,
- 3). 라벨부 배면에 RFID 기능을 수행하기 위한, RFID 안테나(81)를 인쇄하며 인쇄된 RFID 안테나 위로 RFID 칩셋(82)을 장착하고,
- 4). 라벨지(10) 배면의 접착제 자리에 접착제(52)를 도포하고,
- 5). 파단보강제(종이/필름/노끈/리본 등)(70)를 접착제 배면으로 부설하며,
- 6). RFID TAG 모듈/ 접착제(52)/ 파단보강제(70)가 형성된 라벨지(10) 배면에 이형지(60)를 합지하고,
- 7). 라벨부(300) 외곽/ 이형지(60) 외곽을 도무송 한 후,
- 8). RFID 보안봉인라벨의 불필요 부분을 제거하여 포장공급한다.

\*.상기 제작공정 2번 항목의, 특정 정보사항의 인쇄는;

- a. 6번 항목의 합지 후 인쇄하거나,
- b. 7번 항목의 도무송 가공 후 인쇄하거나,
- c. 인쇄 없이 판형세트나 롤형으로 제공하여, 사용자가 직접 프린트할 수도 있다.

### 7. A형 미니 RFID 보안봉인 라벨

[도 19]는 A형 미니 RFID 보안봉인 라벨의 구성요소를 기술하였으며, 미니 RFID 란, RFID 안테나와 RFID 칩셋이 작고 얇은 성형체 안에 일체로 내장되는 RFID 모듈을 의미하며, 4번의 A형 RFID 보안봉인 라벨과 제작방법 및 제공방법이 동일 하다.

### 8. B형 미니 RFID 보안봉인 라벨

[도 20]은 A형 미니 RFID 보안봉인 라벨의 구성요소를 기술하였으며, 미니 RFID 란, RFID 안테나와 RFID 칩셋이 작고 얇은 성형체 안에 일체로 내장되는 RFID 모듈을 의미하며, 5번의 B형 RFID 보안봉인 라벨과 제작방법 및 제공방법이 동일 하다.

### 9. C형 미니 RFID 보안봉인 라벨

[도 21]은 C형 미니 RFID 보안봉인 라벨의 구성요소를 기술하였으며, 미니 RFID 란, RFID 안테나와 RFID 칩셋이 작고 얇은 성형체 안에 일체로 내장되는 RFID 모듈을 의미하며, 6번의 C형 RFID 보안봉인 라벨과 제작방법 및 제공방법이 동일 하다.

### 10. A형 뮤칩 In Lay RFID 보안봉인 라벨

[도 22]은 A형 뮤칩 In Lay RFID 보안봉인 라벨의 구성요소를 기술하였으며, RFID 안테나와 RFID 칩셋이 길고 얇은 성형체에 일체로 형성된, RFID TAG 모듈을 의미하며,

[0187] 4번의 A형 RFID 보안봉인 라벨과 제작방법 및 제공방법이 동일 하다.

[0188] **11. B형 류칩 In Lay RFID 보안봉인 라벨**

[0189] [도 23]은 B형 류칩 In Lay RFID 보안봉인 라벨의 구성요소를 기술하였으며,

[0190] RFID 안테나와 RFID 칩셋이 길고 얇은 성형체에 일체로 형성된, RFID TAG 모듈을 의미하며,

[0191] 5번의 B형 RFID 보안봉인 라벨과 제작방법 및 제공방법이 동일 하다.

[0192] **12. C형 류칩 In Lay RFID 보안봉인 라벨**

[0193] [도 24]는 C형 류칩 In Lay RFID 보안봉인 라벨의 구성요소를 기술하였으며,

[0194] RFID 안테나와 RFID 칩셋이 길고 얇은 성형체에 일체로 형성된, RFID TAG 모듈을 의미하며,

[0195] 6번의 C형 RFID 보안봉인 라벨과 제작방법 및 제공방법이 동일 하다.

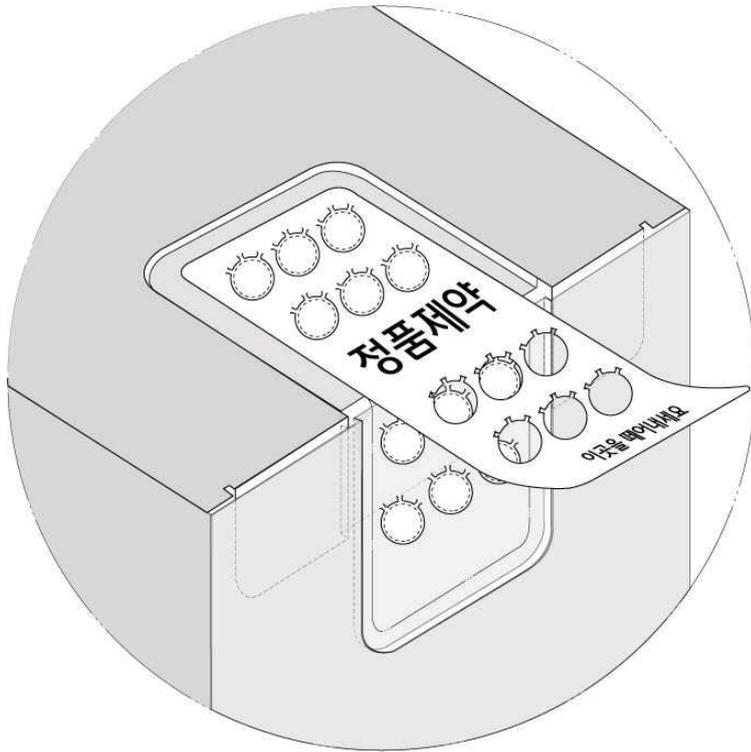
**부호의 설명**

[0196] 10:라벨지, 11:과단 인입부 도무송, 12:과단 점선 도무송, 20:정보표시사항, 30:포인트 과단부, 31:포인트 과단부 지지체, 40:손가락 파지부, 51:점착제, 52:접착제, 53:분리촉진제(금속분말/ 왁스/ 필름 등), 60:점/접착제 보호 이형지, 70:과단 보강용 보강재, 81:RFID 안테나, 82:RFID 칩셋, 83:미니 RFID TAG 모듈, 84:류칩 In Lay RFID TAG 모듈, 90~92:라벨분리 편의를 이형지 가공 수단, 100:이형지에서 분리한 A형 보안봉인라벨 또는 RFID 류형의 A형 보안봉인라벨, 110:A형 보안봉인 라벨모듈 RFID 류형의 A형 보안봉인라벨, 200:이형지에서 분리한 B형 보안봉인라벨 또는 RFID 류형의 B형 보안봉인라벨, 210:B형 보안봉인 라벨모듈 또는 RFID 류형의 B형 보안봉인라벨, 300:이형지에서 분리한 C형 보안봉인라벨 또는 RFID 류형의 C형 보안봉인라벨, 310:C형 보안봉인 라벨모듈 또는 RFID 류형의 C형 보안봉인라벨

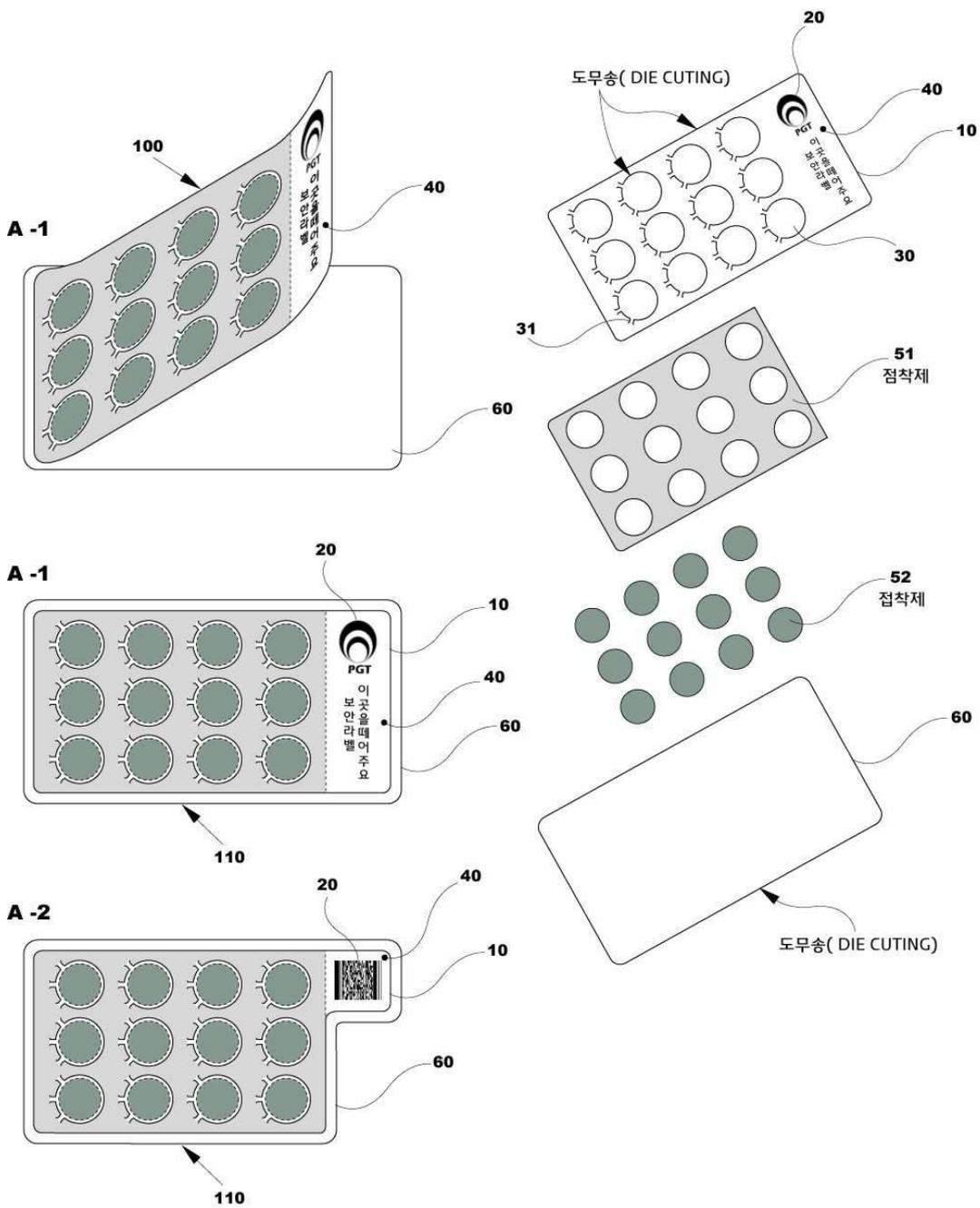
도면

도면1

A

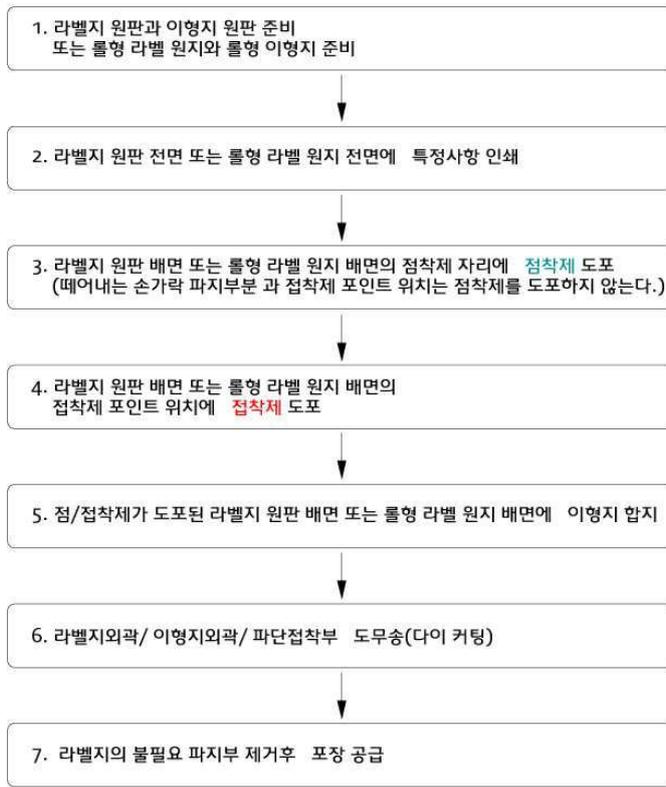


도면2



도면3

A형 보안 봉인 라벨의 제작공정 및 제공방법



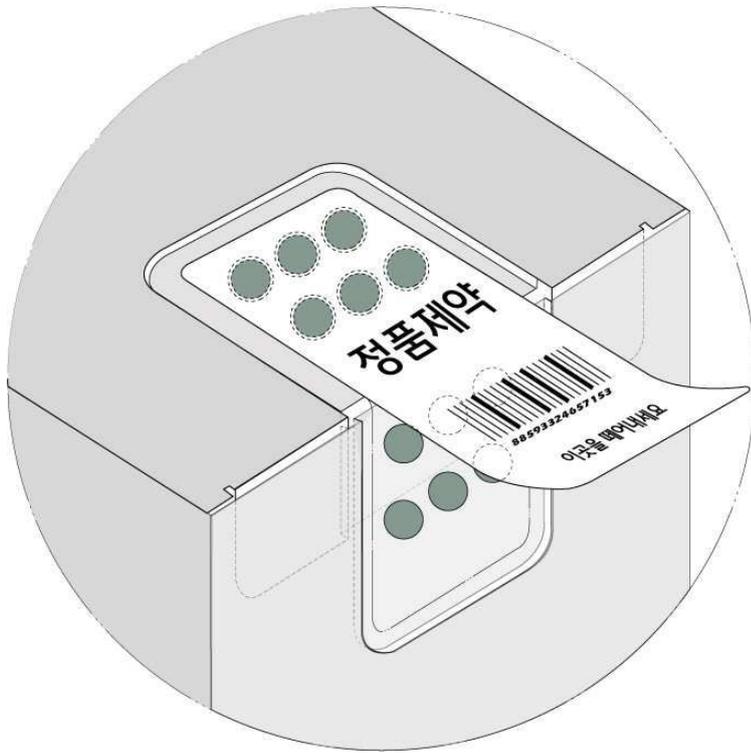
\*. 2번 항목의 특정사항 인쇄는;

- a. 5번 항목의 합지후 특정사항을 인쇄 할 수도 있으며,
- b. 6번 항목의 도무송 후 특정사항을 인쇄 할 수도 있다.

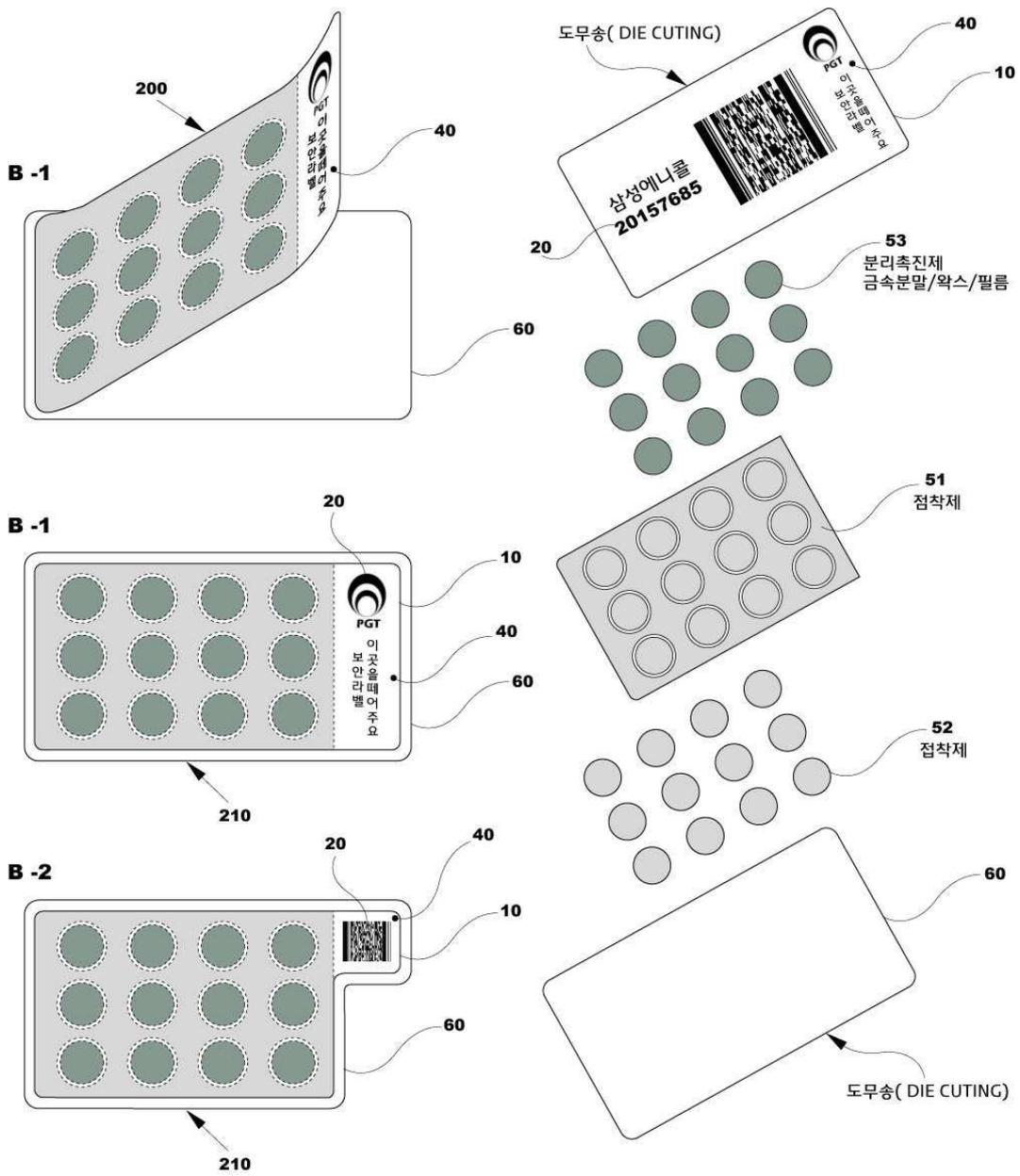
\*. 인쇄없이 판형세트나 롤형으로 제공되어, 소비자가 직접 프린트 할 수도 있다.

도면4

B

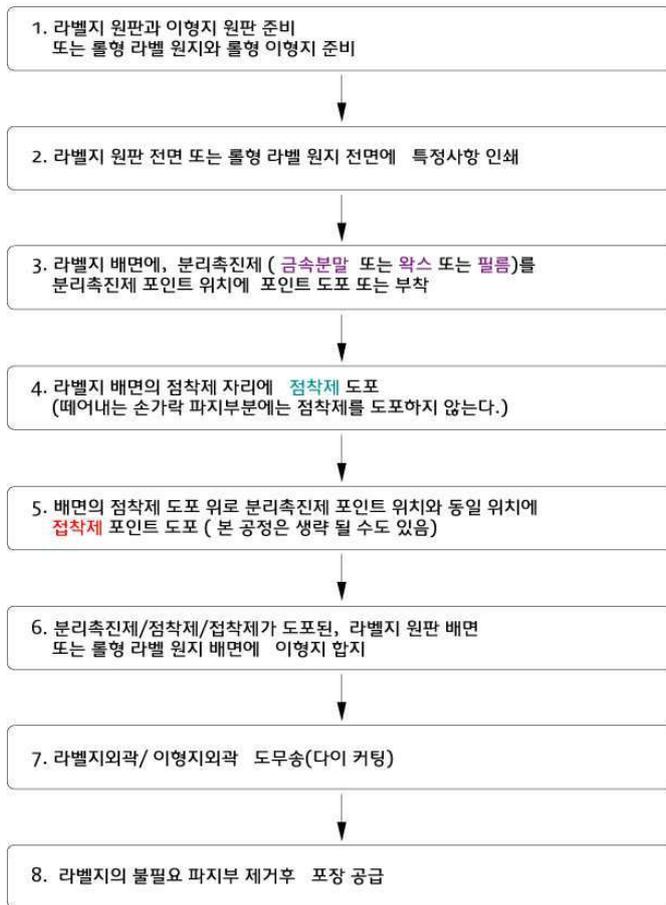


도면5



도면6

B형 보안 봉인 라벨의 제작공정 및 제공방법



\*. 2번 항목의 특정사항 인쇄는;

- a. 6번 항목의 합지후 특정사항을 인쇄 할 수도 있으며,
- b. 7번 항목의 도무송 후 특정사항을 인쇄 할 수도 있다.

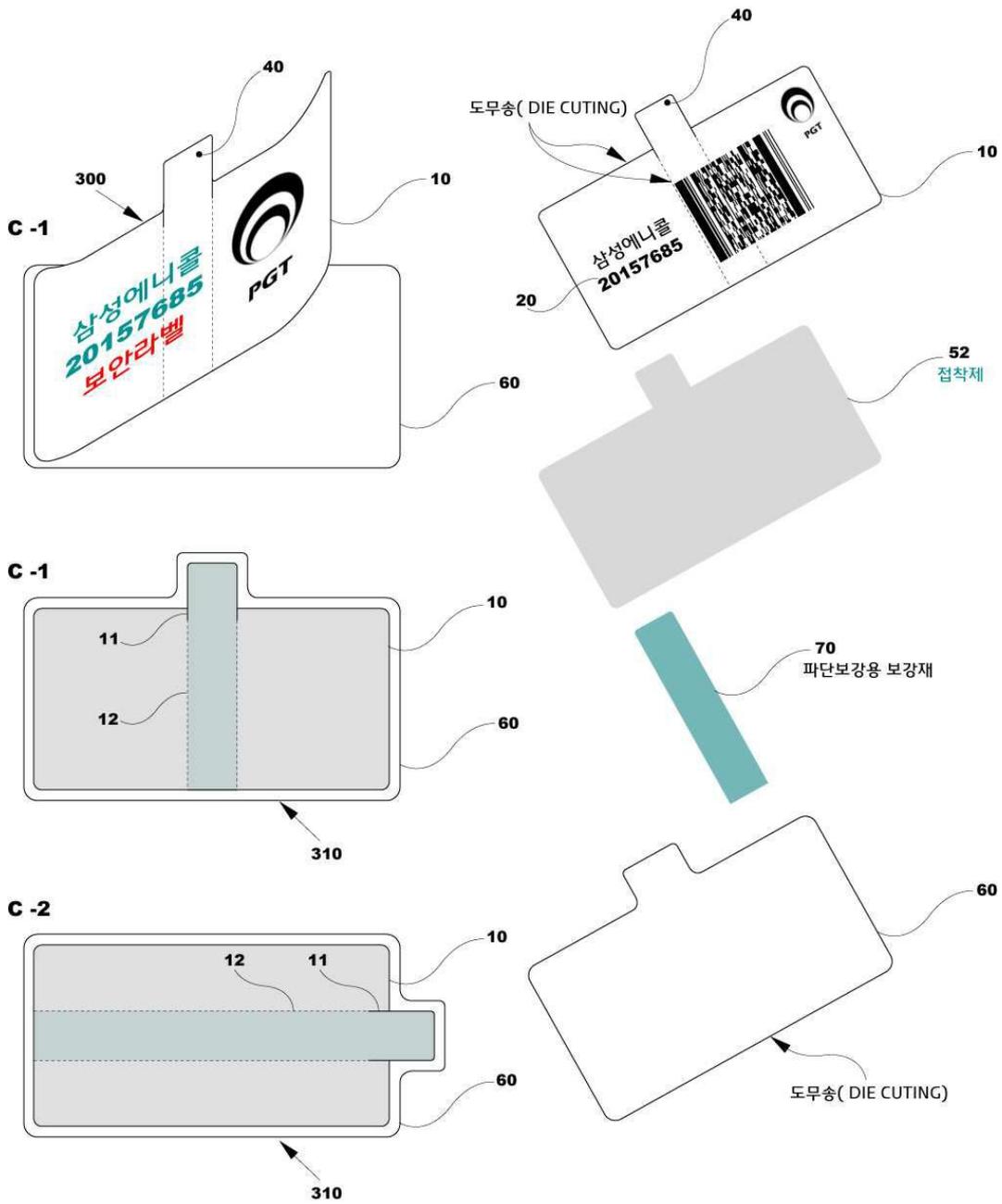
\*. 인쇄없이 판형세트나 롤형으로 제공되어, 소비자가 직접 프린트 할 수도 있다.

도면7

C

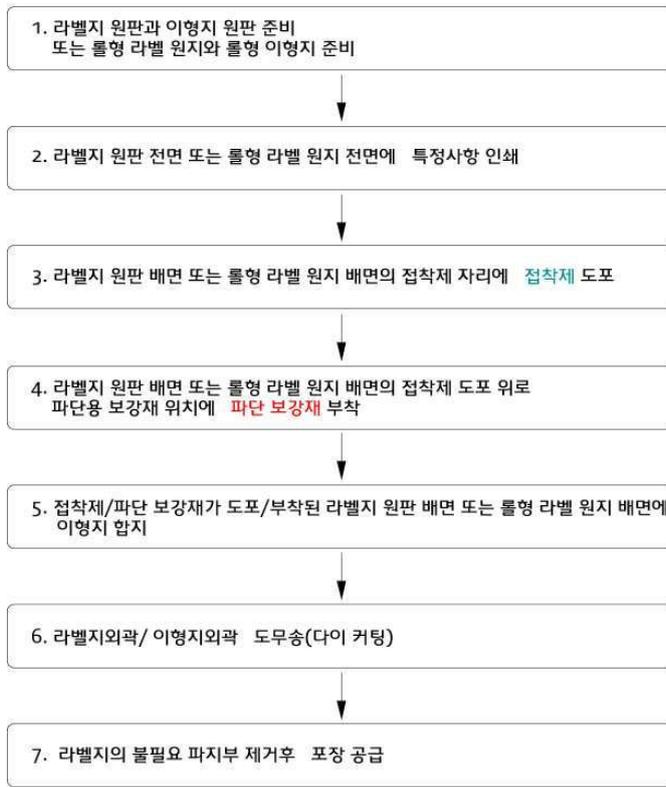


도면8



도면9

c형 보안 봉인 라벨의 제작공정 및 제공방법



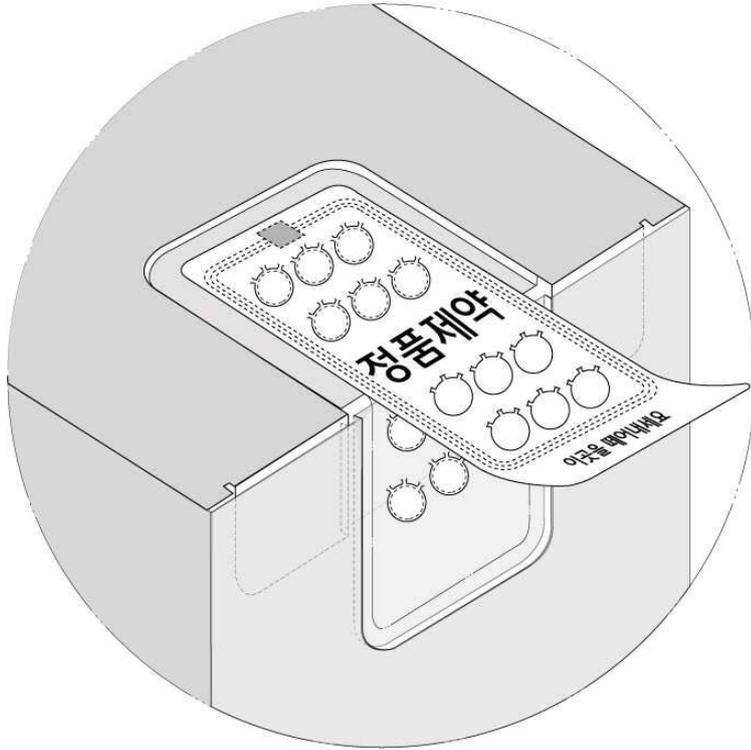
\*. 2번 항목의 특정사항 인쇄는;

- a. 5번 항목의 합지후 특정사항을 인쇄 할 수도 있으며,
- b. 6번 항목의 도무송 후 특정사항을 인쇄 할 수도 있다.

\*. 인쇄없이 판형세트나 롤형으로 제공되어, 소비자가 직접 프린트 할 수도 있다.

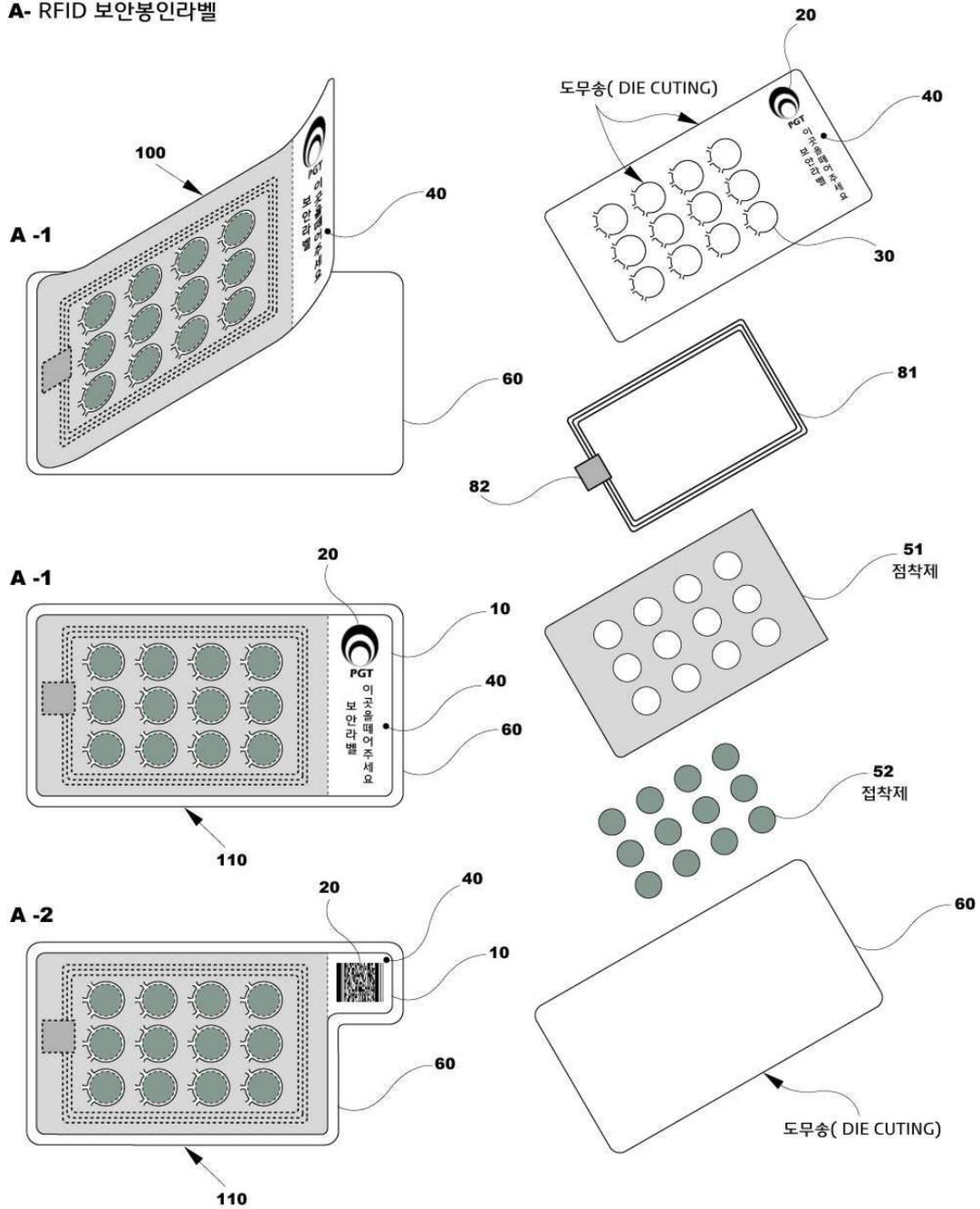
도면10

A- RFID 보안봉인라벨



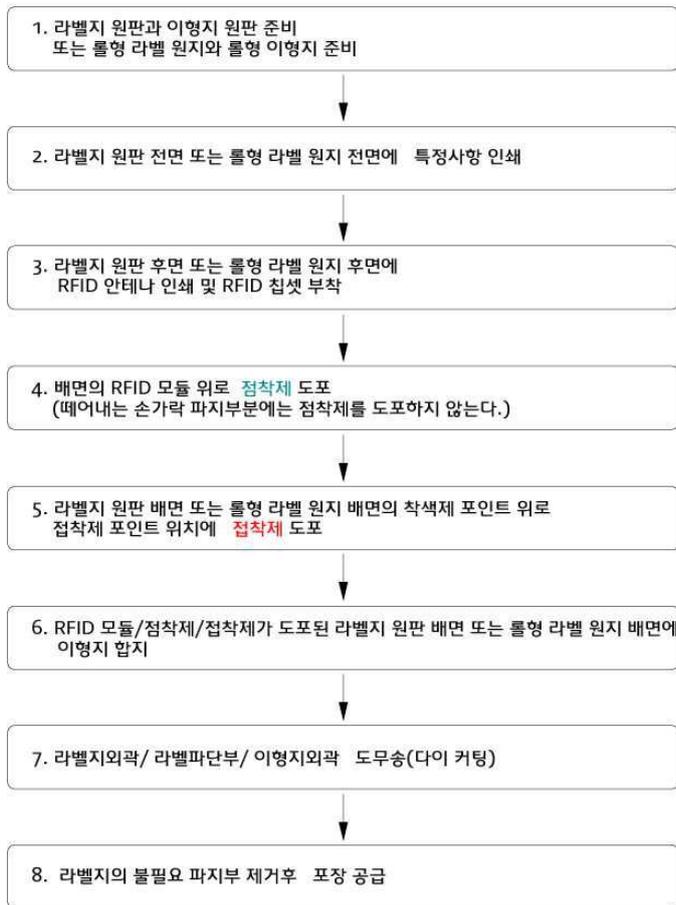
도면11

A- RFID 보안봉인라벨



도면12

A형 RFID 보안 봉인 라벨의 제작공정 및 제공방법



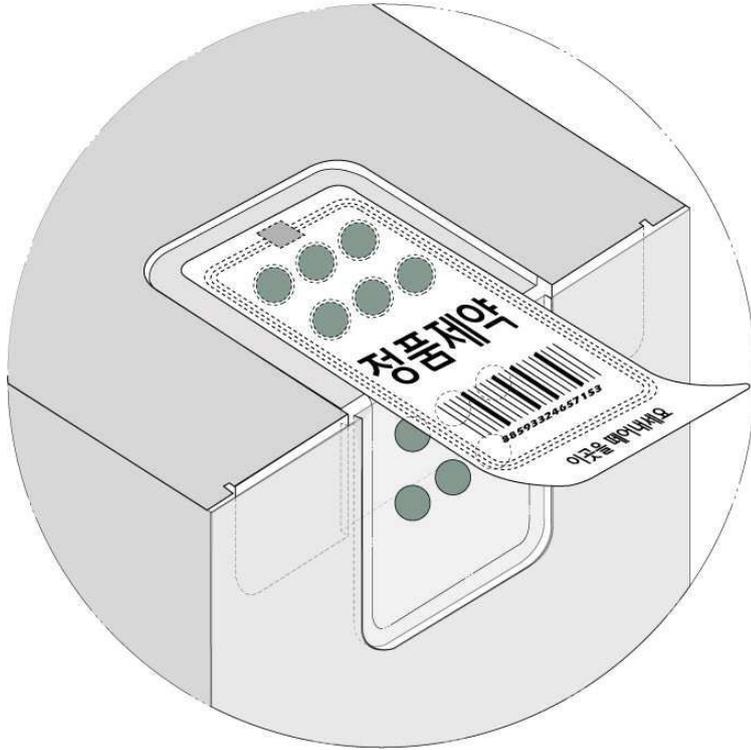
\*. 2번 항목의 특정사항 인쇄는;

- a. 6번 항목의 합지후 특정사항을 인쇄 할 수도 있으며,
- b. 7번 항목의 도무송 후 특정사항을 인쇄 할 수도 있다.

\*. 인쇄없이 판형세트나 롤형으로 제공되어, 소비자가 직접 프린트 할 수도 있다.

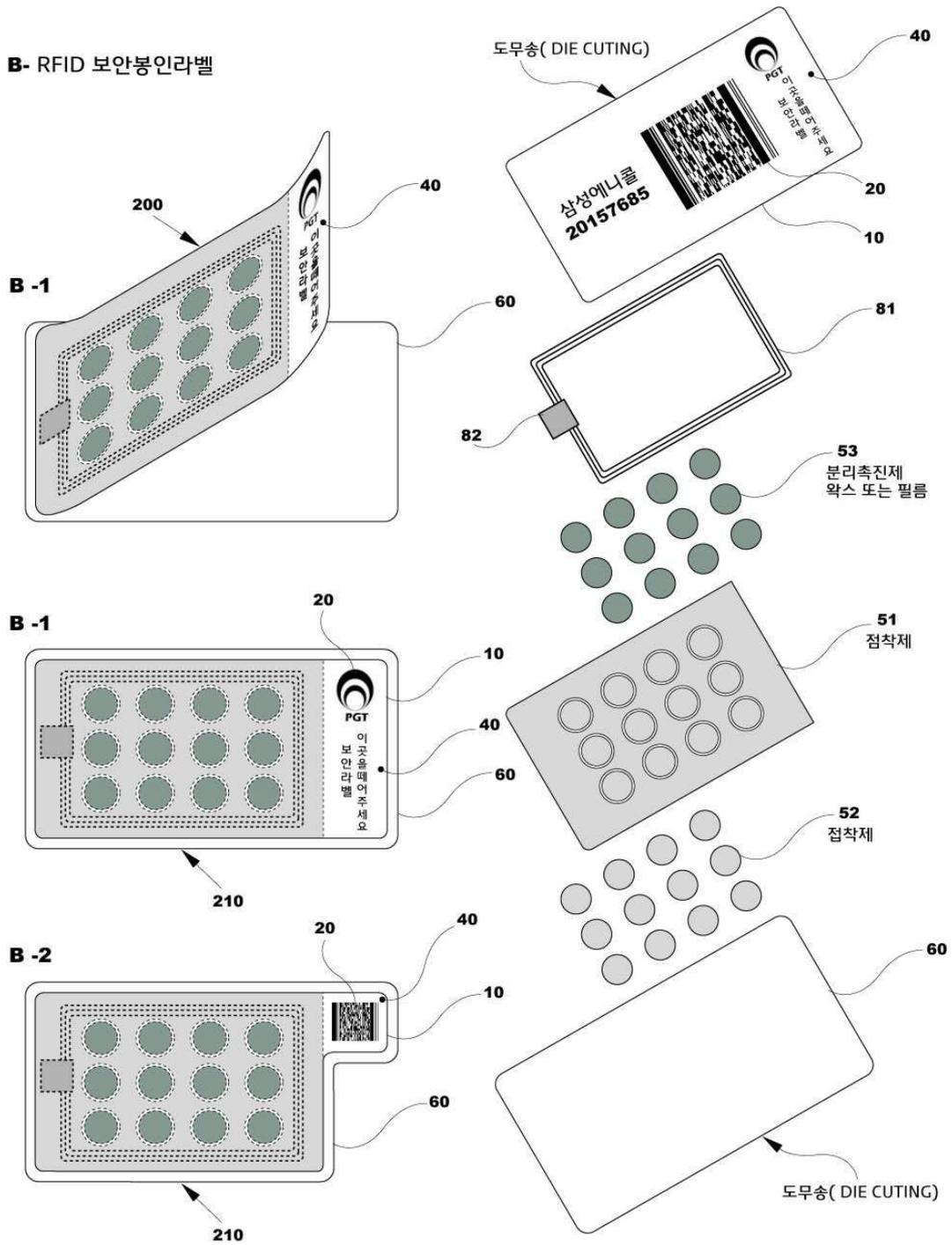
도면13

B- RFID 보안봉인라벨



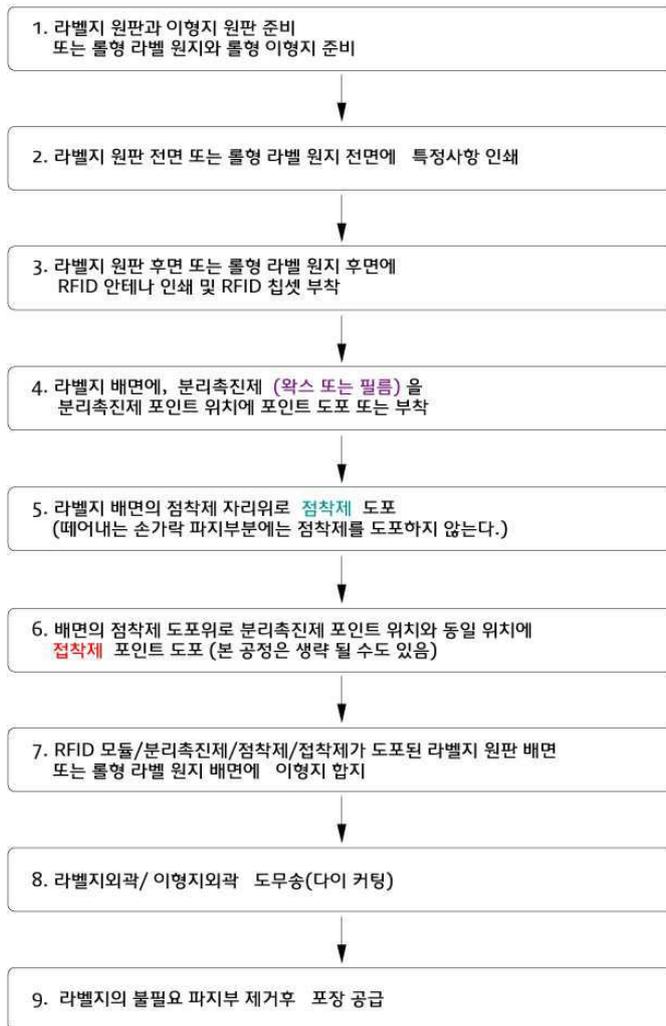
도면14

B- RFID 보안봉인라벨



도면15

B형 RFID 보안 봉인 라벨의 제작공정 및 제공방법



\*. 2번 항목의 특정사항 인쇄는;

- a. 7번 항목의 합지후 특정사항을 인쇄 할 수도 있으며,
- b. 8번 항목의 도무송 후 특정사항을 인쇄 할 수도 있다.

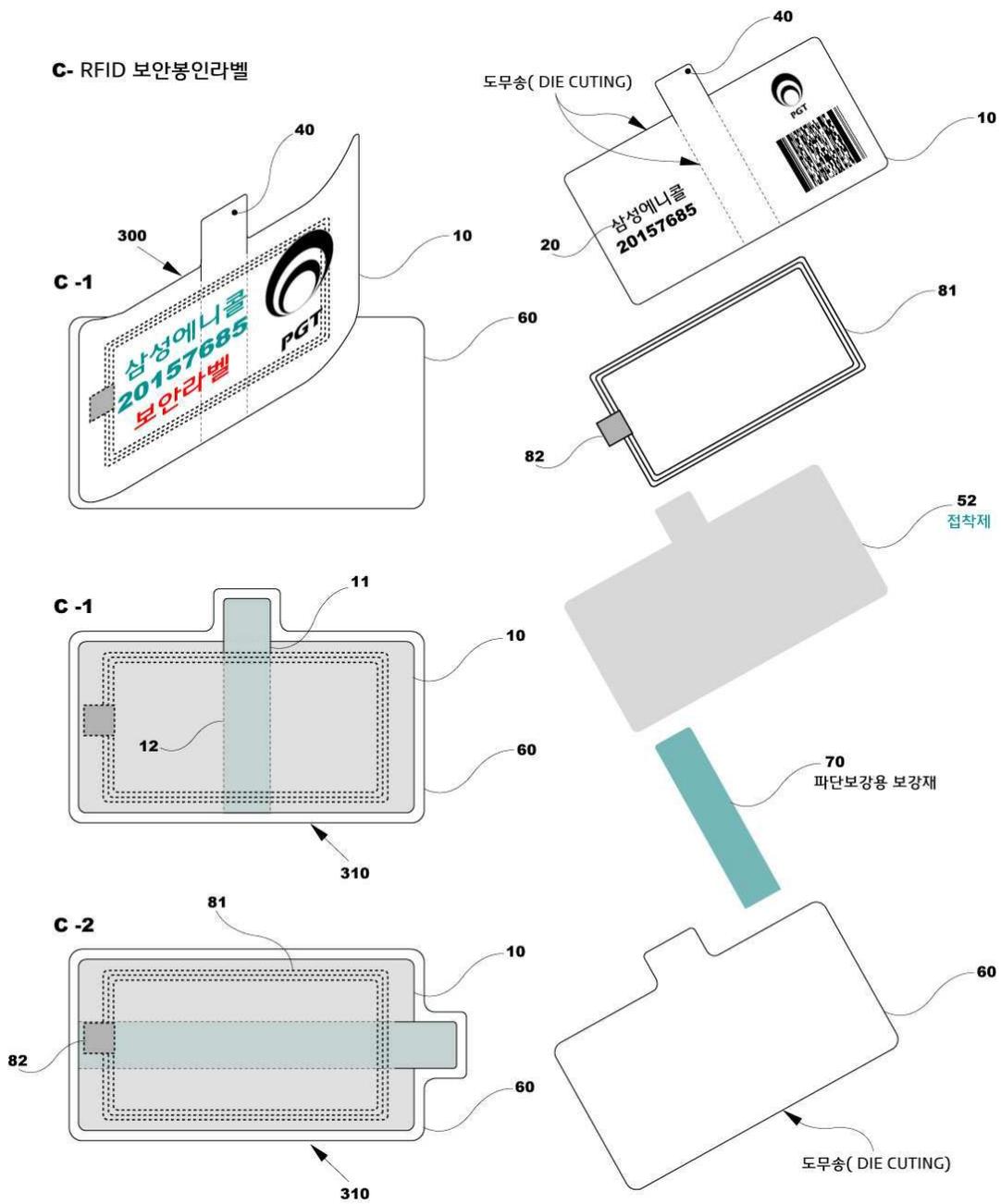
\*. 인쇄없이 판형세트나 롤형으로 제공되어, 소비자가 직접 프린트 할 수도 있다.

도면16

C- RFID 보안봉인라벨

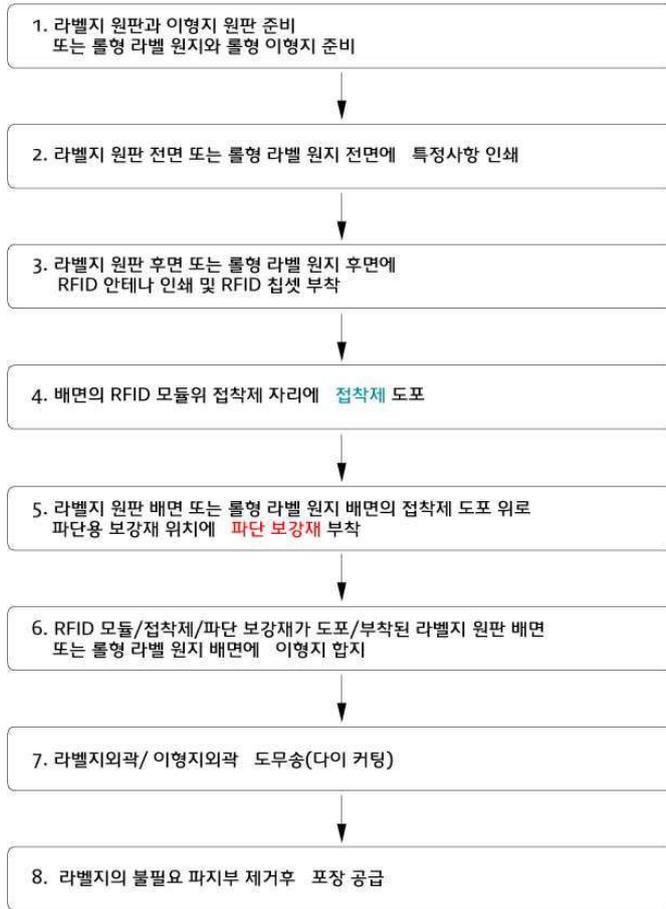


도면17



도면18

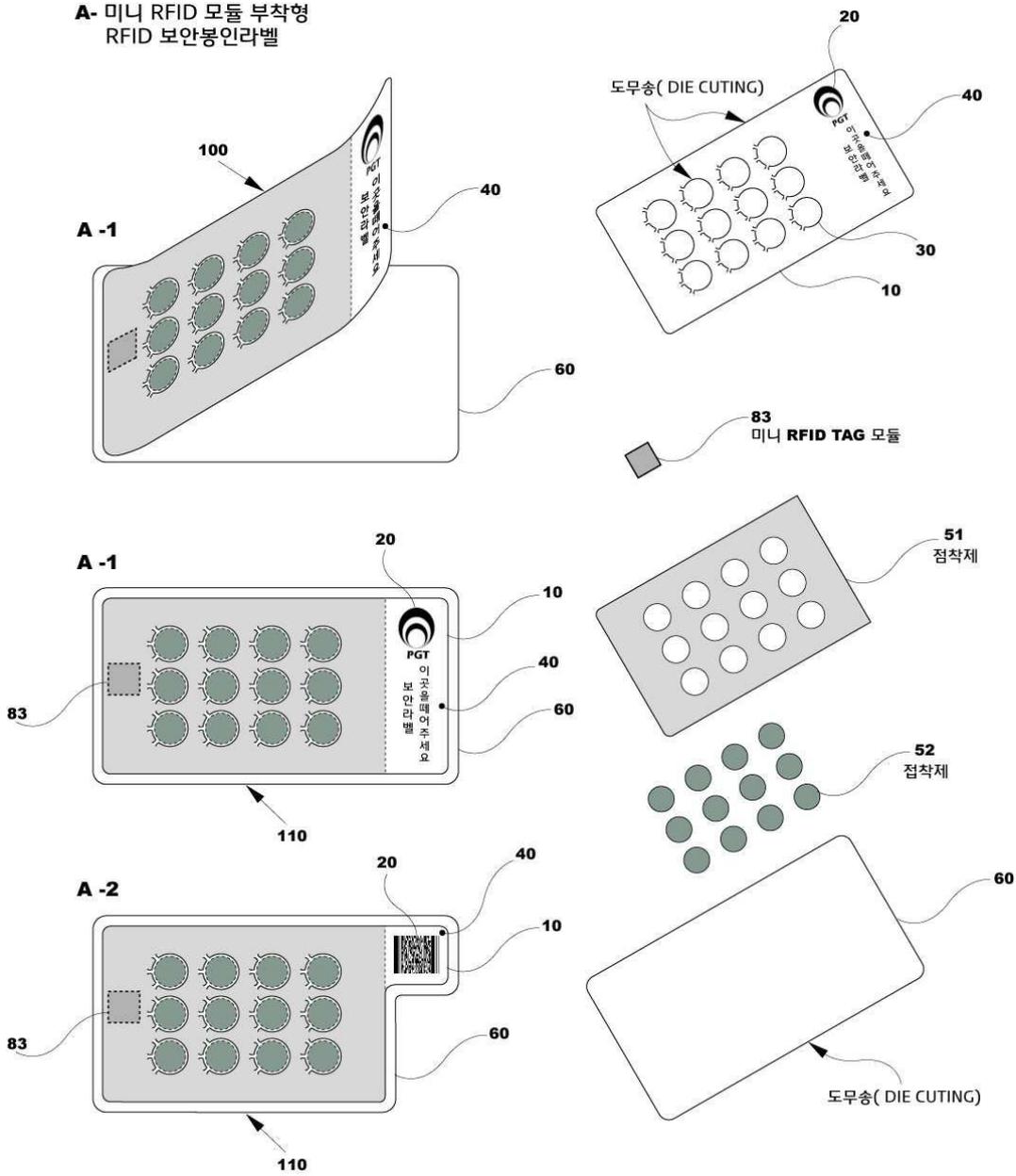
c형 RFID 보안 봉인 라벨의 제작공정 및 제공방법



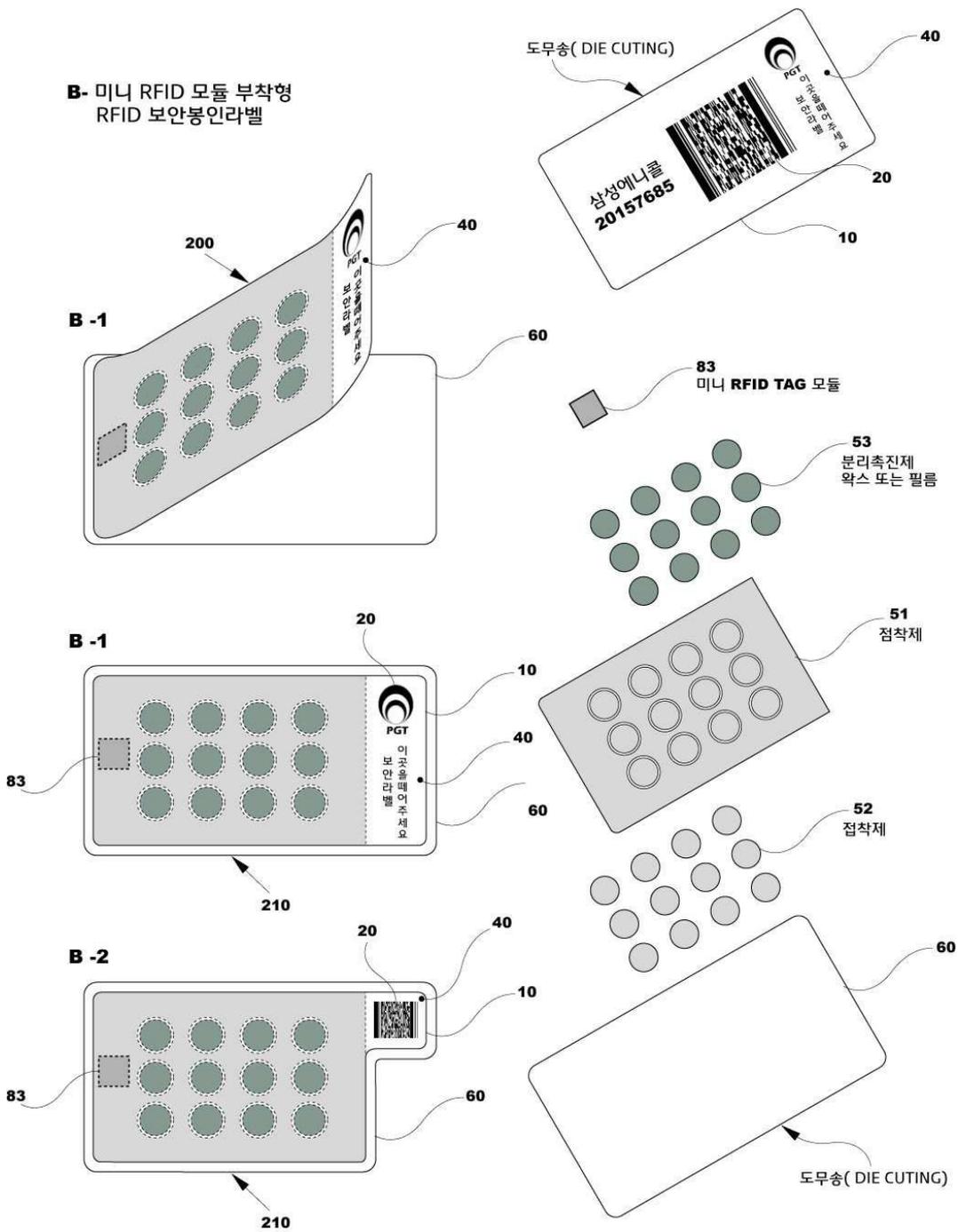
- \*. 2번 항목의 특정사항 인쇄는;
  - a. 6번 항목의 합지후 특정사항을 인쇄 할 수도 있으며,
  - b. 7번 항목의 도무송 후 특정사항을 인쇄 할 수도 있다.
- \*. 인쇄없이 판형세트나 롤형으로 제공되어, 소비자가 직접 프린트 할 수도 있다.

도면19

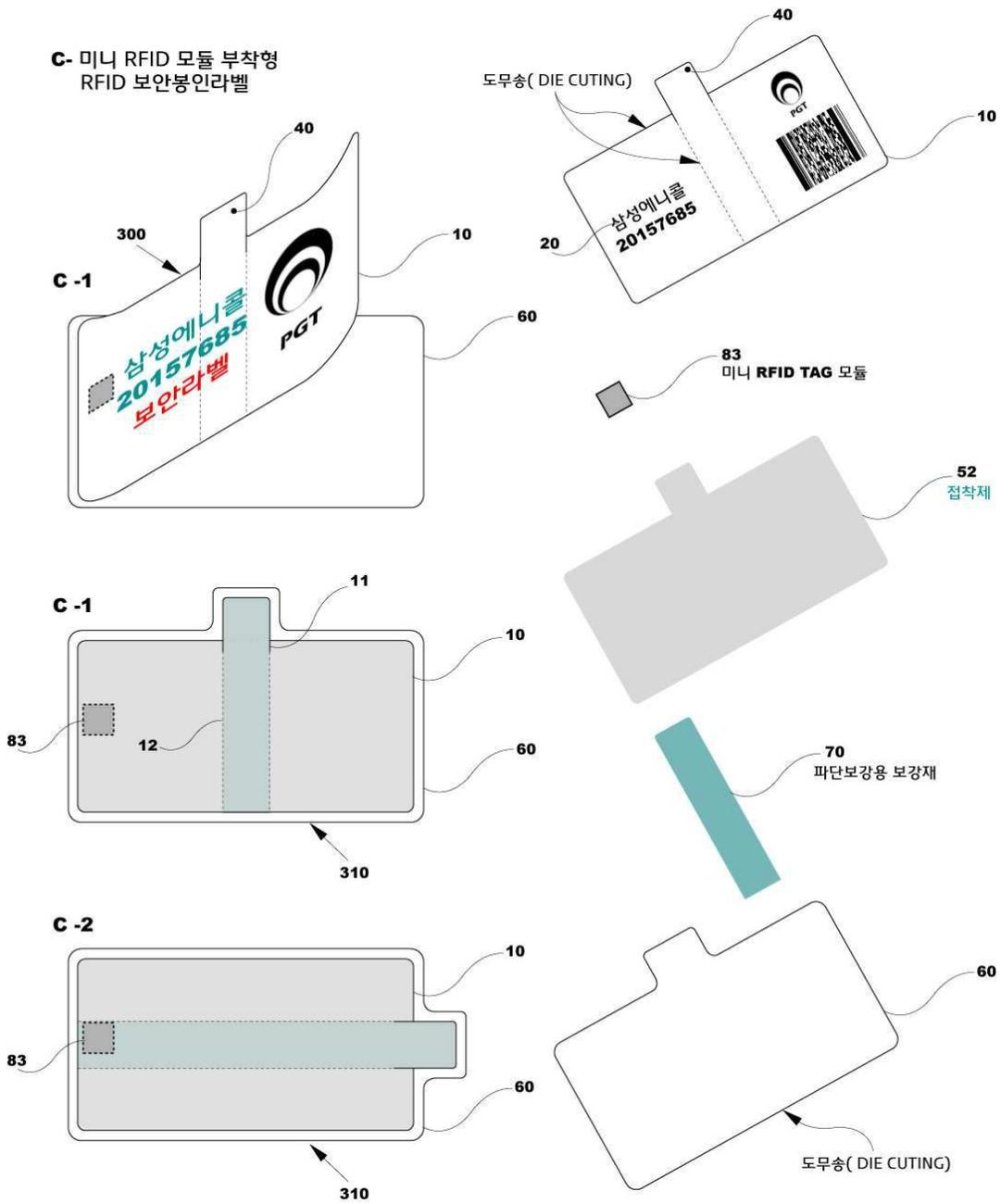
A- 미니 RFID 모듈 부착형  
RFID 보안봉인라벨



도면20

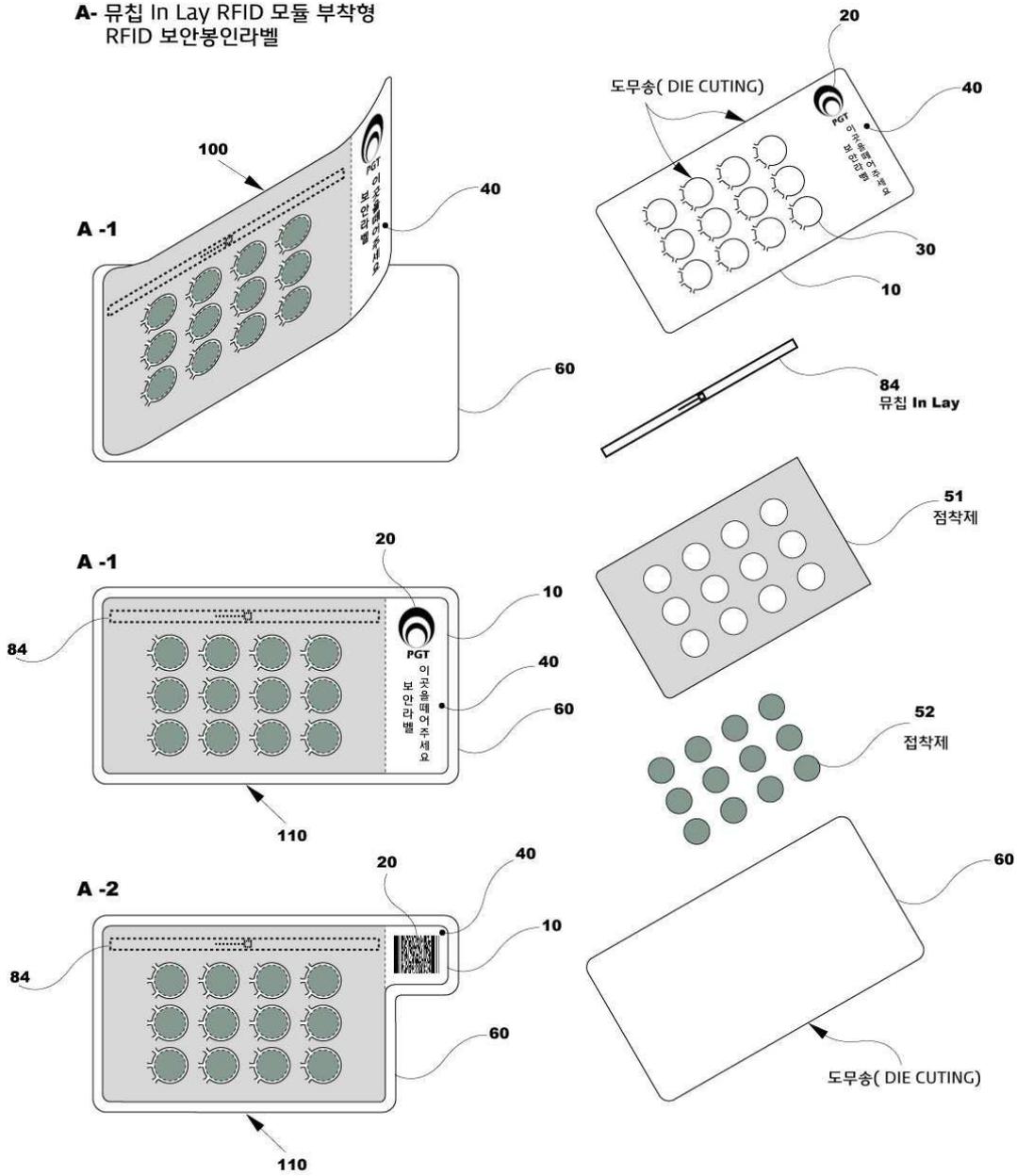


도면21

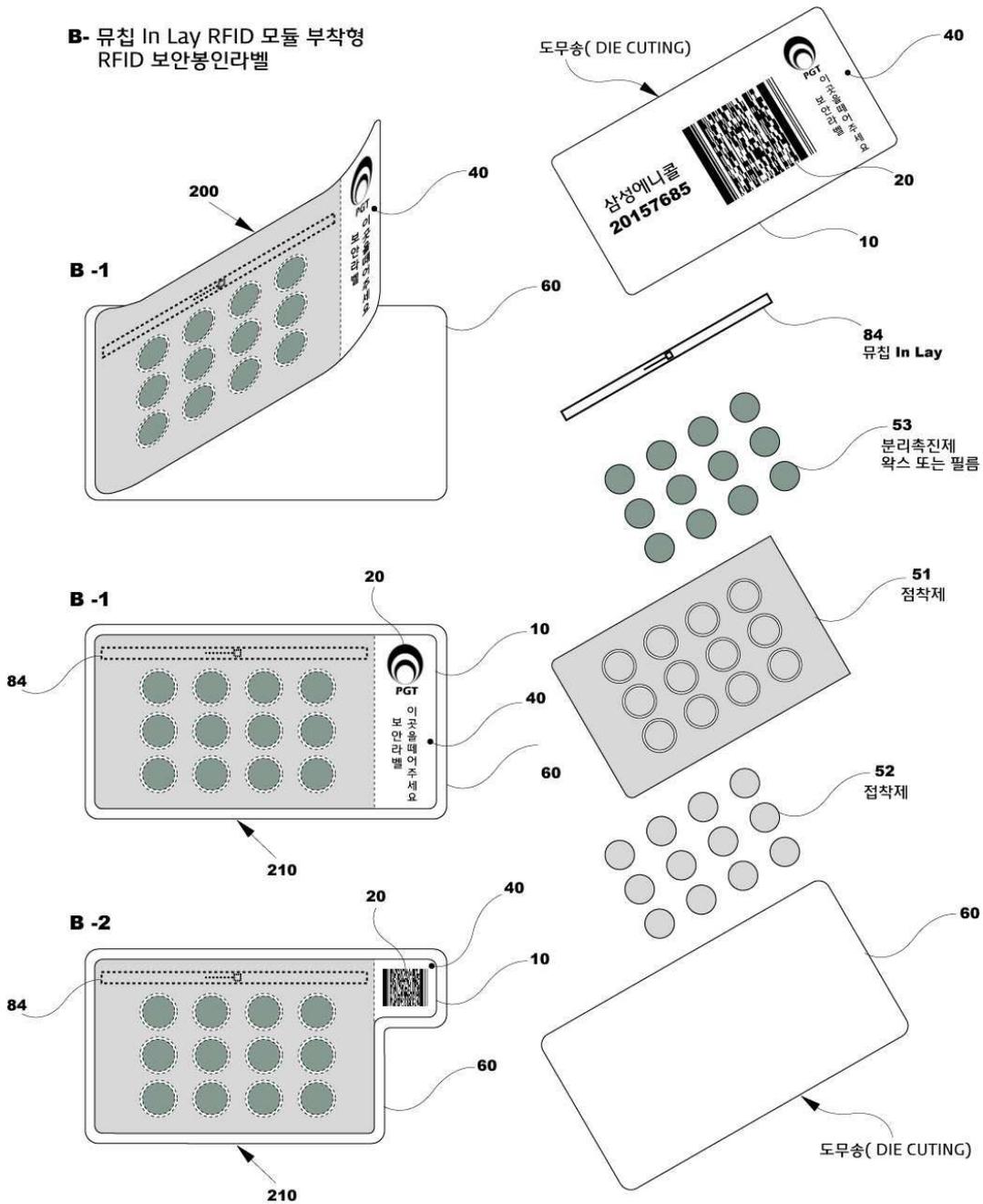


도면22

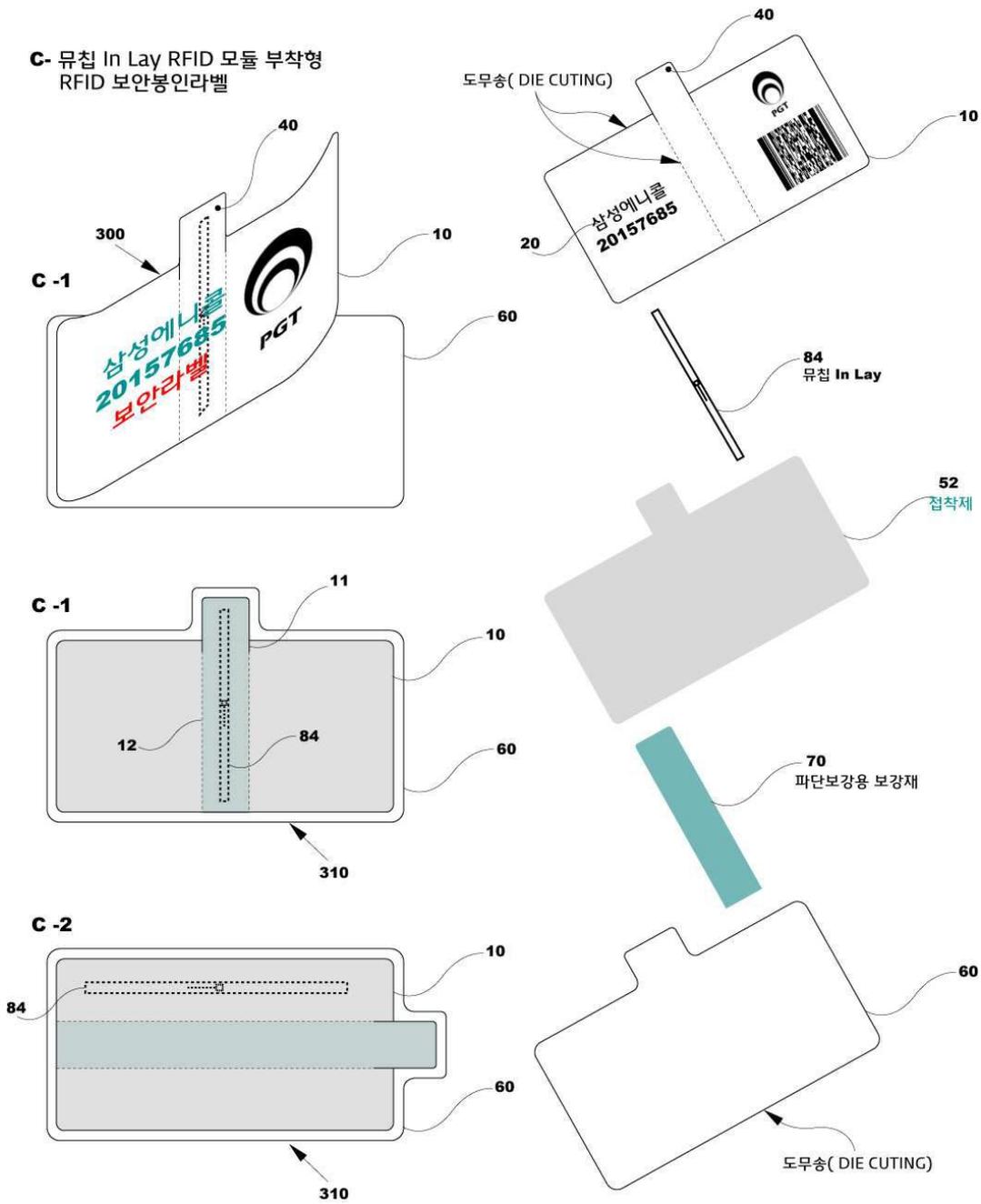
A- 유칩 In Lay RFID 모듈 부착형  
RFID 보안봉인라벨



도면23



도면24

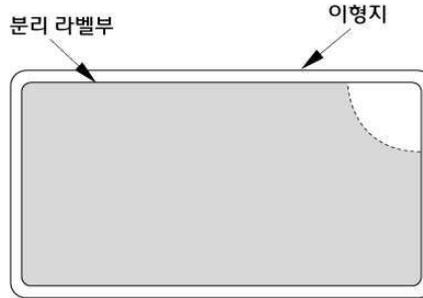


도면25

보안봉인라벨과 RFID 보안봉인라벨의 다양한, 이형지와 손가락 파지부의 유형



라벨 배면의 손가락 파지부 외 점착제 도포형 - 1



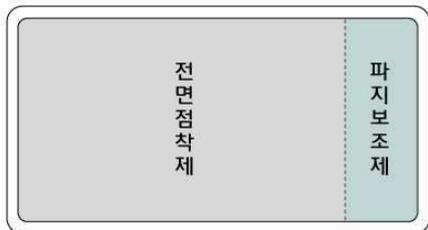
라벨 배면의 손가락 파지부 외 점착제 도포형 - 3



라벨 배면의 손가락 파지부 외 점착제 도포형 - 2



라벨 배면의 손가락 파지부 외 점착제 도포형 - 4  
라벨부와 이형지 동일 규격으로 도무승



라벨 배면 점착제 도포 후 손가락 파지보조제 부착형 -1



라벨 배면 점착제 도포 후 손가락 파지보조제 부착형 -3



라벨 배면 점착제 도포 후 손가락 파지보조제 부착형 -2



라벨 배면 점착제 도포 후 손가락 파지보조제 부착형 -2  
라벨부와 이형지 동일 규격으로 도무승

도면26

\* 라벨의 분리 편의를 위한  
이형지 가공의 다른 예

